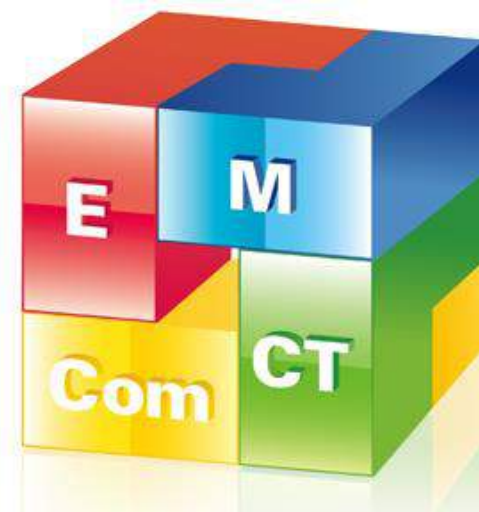


世界に通用する技術で未来を創出

Our Technologies Realize Your Dreams

2017年3月期 第2四半期連結決算説明資料



2016年11月24日
オリジン電気株式会社

目次

2017年3月期 第2四半期連結決算説明

◇決算の概要	P 3	◇17/3期連結業績予想	P 13
◇経営成績	P 4	◇【ご参考】連結経営成績の推移	P 14
◇セグメント別連結売上高	P 5	◇エレクトロニクス事業部門	P 15～ P 26
◇海外顧客向け連結売上高	P 6	◇メカトロニクス事業部門	P 27～ P 40
◇セグメント利益	P 7	◇ケミトロニクス事業部門	P 41～ P 50
◇減価償却費	P 8	◇コンポーネント事業部門	P 51～ P 60
◇研究開発費・売上高研究開発費比率	P 9	◇研究開発本部	P 61～ P 64
◇財政の状況	P 10		
◇キャッシュ・フローの状況	P 11		
◇配当の状況	P 12		

第2四半期連結累計期間 決算の概要



◇上期概要

売上高	:	15,021 百万円	(前年同四半期比 ▲ 9.3%)
営業利益	:	377 百万円	(前年同四半期比 ▲62.9%)
経常利益	:	312 百万円	(前年同四半期比 ▲72.8%)
親会社株主に帰属する当期純利益	:	▲1,717 百万円	(前年同四半期比 —)

※%表示は対前年同四半期比増減率。

◇下期重点施策

1. お客様満足度を高める研究、開発、技術、購買、生産、販売力の強化
2. 基盤となる社内グローバルインフラの強化
3. 世界で活躍する人財の育成
4. グループによる共創

◇17/3期連結業績予想

売上高	:	33,000 百万円	(前期比 1.9%)
営業利益	:	1,500 百万円	(前期比 ▲ 3.9%)
経常利益	:	1,450 百万円	(前期比 ▲17.6%)
親会社株主に帰属する当期純利益	:	▲783 百万円	(前期比 —)

※%表示は対前期増減率。

第2四半期連結累計期間 経営成績



(単位:百万円)

	17/3期 上期	16/3期 上期	前年同 四半期比	主な内訳						
売上高	15,021	16,564	▲ 9.3%	エレクトロ 3,534 15.9%減 メカトロ 1,969 21.1%増 ケミトロ 5,263 4.1%減 コンポーネント 4,252 19.0%減						
営業利益	377	1,016	▲ 62.9%	セグメント利益 エレクトロ ▲125 メカトロ 195 ケミトロ 827 コンポーネント 429 調整額 ▲949 合計 377						
経常利益	312	1,149	▲ 72.8%	※調整額は各セグメントに配分していない全社費用であります。 ・前年同四半期に比べ、コンポーネント事業及びエレクトロニクス事業の売上が減少したことに伴い、営業利益は前年同四半期に比べ639百万円減少しました。 ・営業外収益に受取利息38百万円、受取配当金48百万円等を計上しましたが、為替差損164百万円を計上したことにより経常利益312百万円となりました。						
親会社株主に帰属する四半期純利益	▲1,717	715	—	・特別利益に固定資産解体費用引当金戻入益54百万円、特別損失に環境対策引当金繰入額1,538百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は▲1,717百万円となりました。						

(単位:円)

1株当たり 四半期純利益	▲ 51.52	21.46
-----------------	---------	-------

◆POINT◆

平成28年10月11日開催の取締役会において、旧本社工場跡地の有効活用及び旧本社工場地下部解体等撤去更地化工事の実施について決議いたしました。上記敷地において土壌汚染対策法に抵触する土壌・地下水汚染が判明したため、旧本社工場地下部解体工事とともに土壌汚染改良工事を行うこととなりました。これらの工事費用の見積額について、環境対策引当金繰入額として当第2四半期連結累計期間において特別損失に15億3千8百万円計上しております。

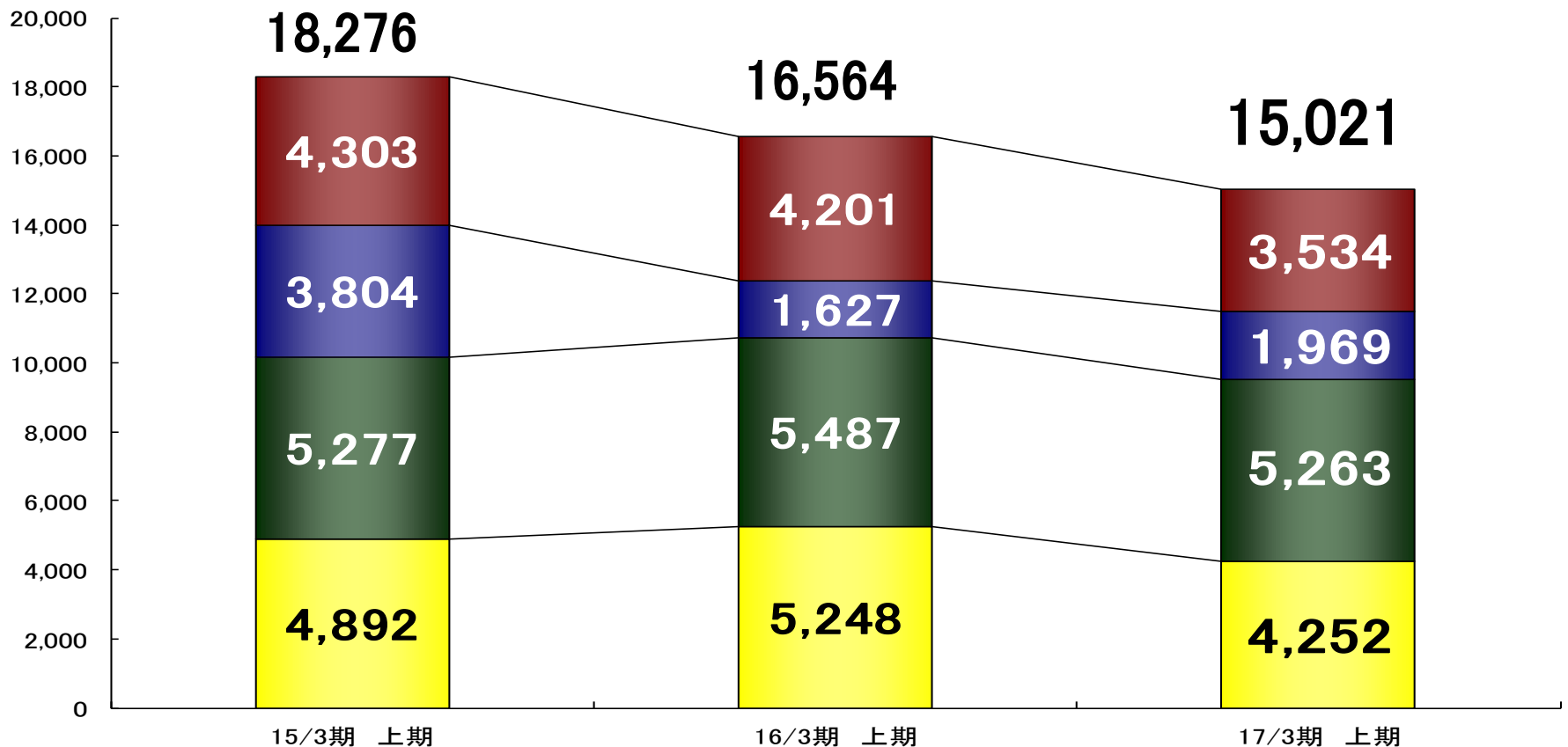
なお、有効活用を図ることを目的とした一般定期借地権設定契約に係る権利金・地代収入は、平成32年3月期以降の業績に寄与することになります。

第2四半期連結累計期間 セグメント別連結売上高



■ エレクトロニクス事業部門 ■ メカトロニクス事業部門
■ ケミトロニクス事業部門 ■ コンポーネント事業部門

(単位:百万円)

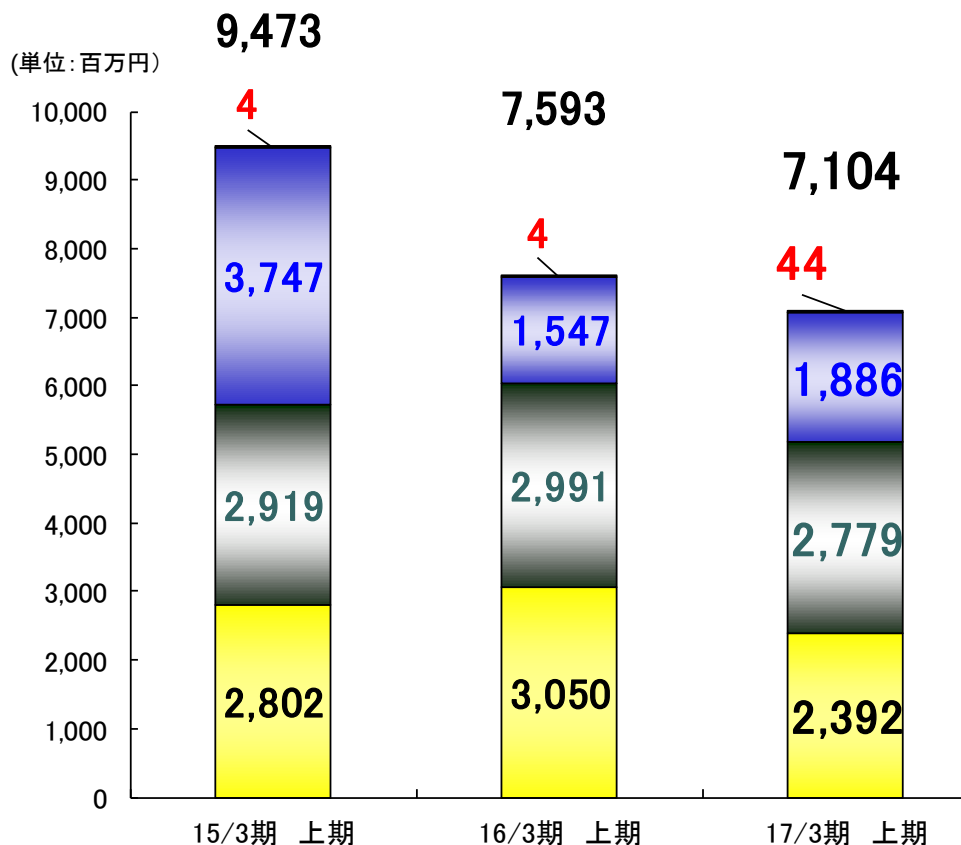


第2四半期連結累計期間 海外顧客向け連結売上高



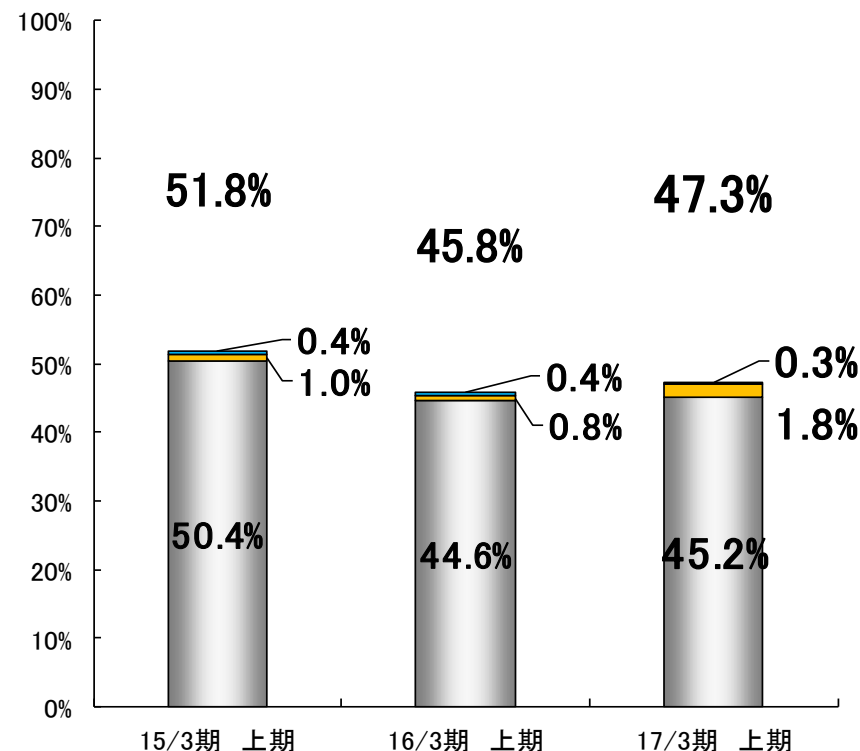
ーセグメント別ー

■ エレクトロニクス事業部門 ■ メカトロニクス事業部門
□ ケミトロニクス事業部門 ■ コンポーネント事業部門



ー地域別ー

■ その他地域 ■ 北米 □ アジア



第2四半期連結累計期間 セグメント利益（全社費用配分前）



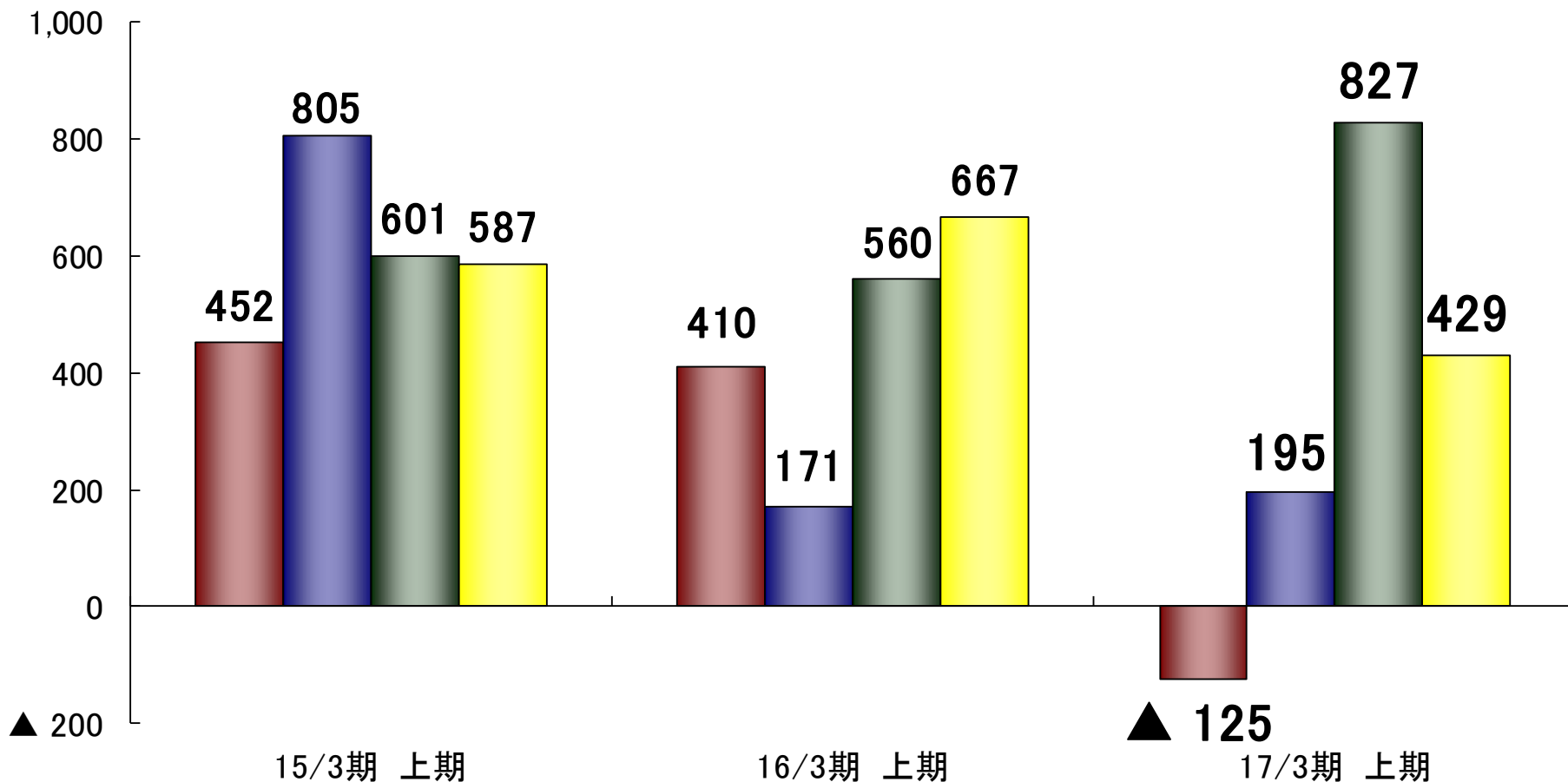
■ エレクトロニクス事業部門

■ メカトロニクス事業部門

■ ケミトロニクス事業部門

■ コンポーネント事業部門

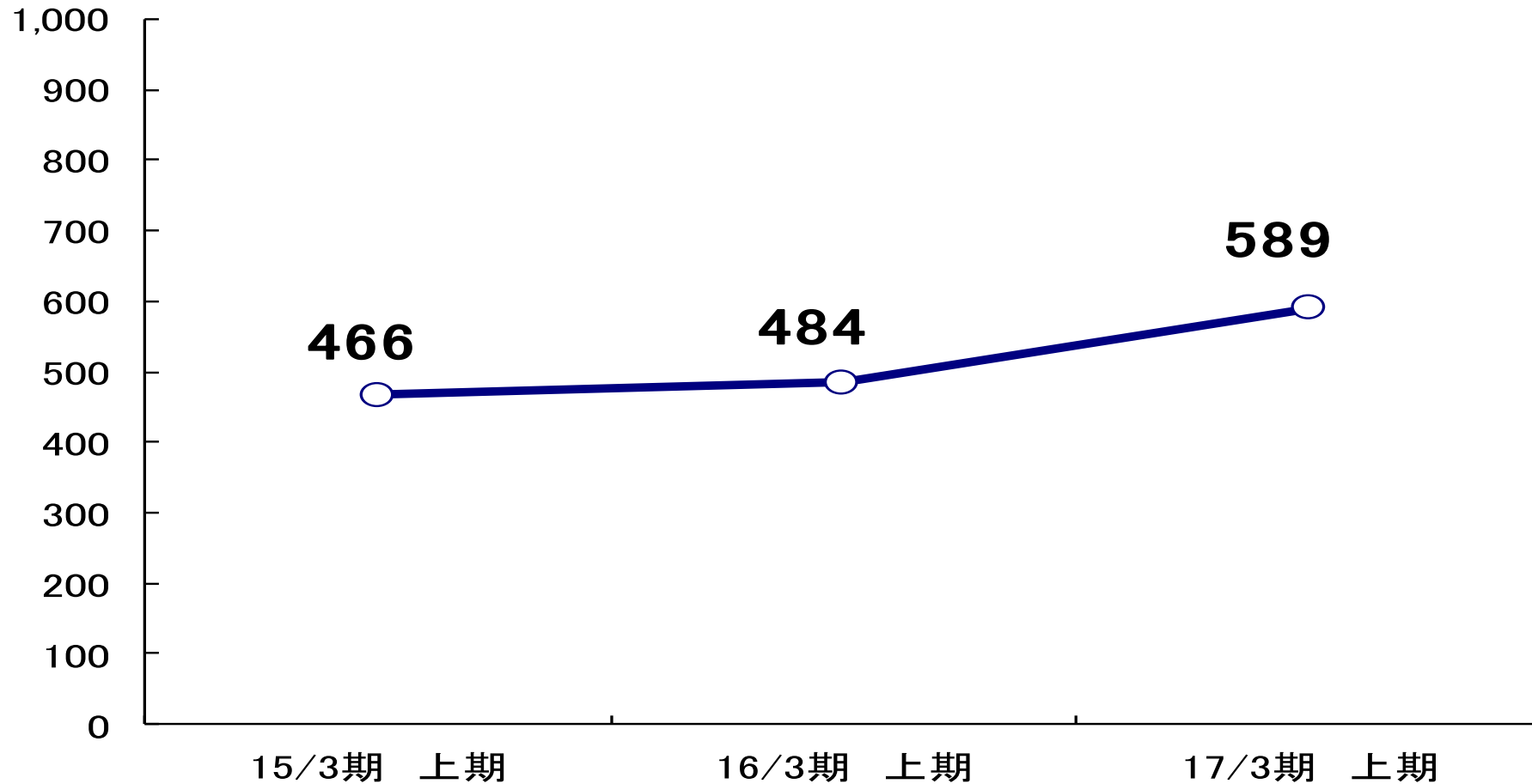
(単位:百万円)



第2四半期連結累計期間 減価償却費



(単位: 百万円)

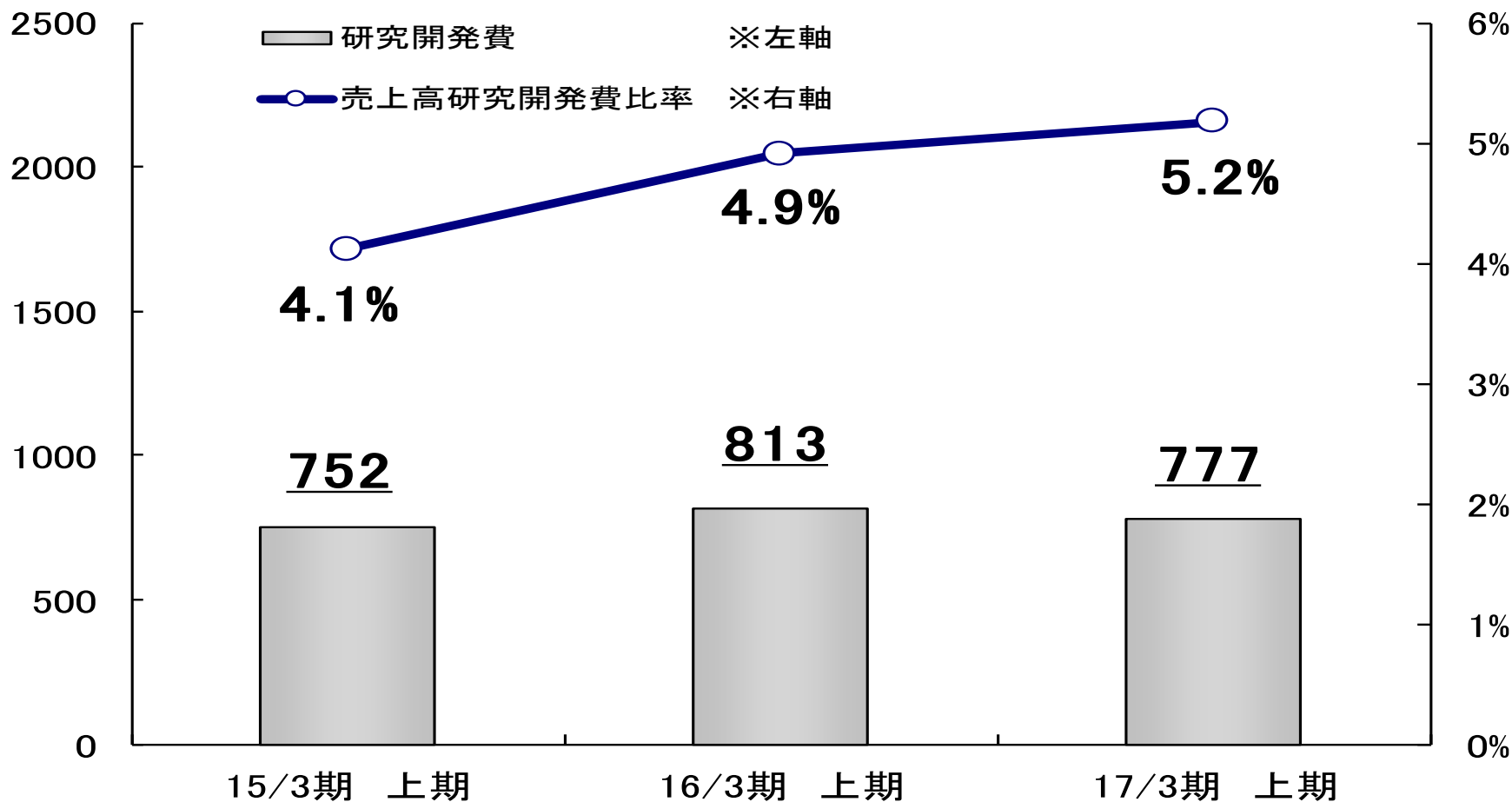


第2四半期連結累計期間

研究開発費、売上高研究開発費比率



(単位:百万円)



第2四半期連結会計期間末 財政の状態



(単位:百万円)

	16/9/30	16/3/31	前期末比	主な項目
流動資産	24,283	25,935	▲ 1,652	現金及び預金1,329減少、繰延税金資産270減少
固定資産	16,329	16,828	▲ 499	建物及び構築物383減少、無形固定資産73減少
流動負債	11,134	12,556	▲ 1,422	短期借入金1,200減少、支払手形及び買掛金683減少
固定負債	7,139	4,652	2,486	環境対策引当金1,538増加、長期借入金900増加
純資産	22,339	25,555	▲ 3,216	
総資産	40,612	42,764	▲ 2,151	

自己資本比率	49.7%	53.7%	▲ 4.0%
--------	-------	-------	--------

◆POINT◆

- ・純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定が減少したことなどにより、前会計年度末より32億16百万円減少し、223億39百万円となりました。
- ・総資産も前会計年度末より21億51百万円減少し、406億12百万円となりました。
- ・自己資本比率は前会計年度末より4%減少し、49.7%となりました。

第2四半期連結累計期間 キャッシュ・フローの状況



(単位:百万円)

	17/3期 上期	16/3期 上期	前年同 四半期比	主な項目
営業活動によるC/F	▲ 84	454	▲ 538	資金の増加要因:環境対策引当金の増加1,538、減価償却費589 資金の減少要因:税金等調整前四半期純損失1,170、仕入債務の減少549、売上債権の増加額499
投資活動によるC/F	▲ 1	▲ 1,149	1,148	資金の増加要因:定期預金の純増額444 資金の減少要因:有形固定資産の取得による支出361、無形固定資産の取得による支出56
財務活動によるC/F	38	63	▲ 25	資金の増加要因:長期借入による収入2,000 資金の減少要因:短期借入金純減額1,200、長期借入金の返済による支出431、 非支配株主への配当金の支払額198、配当金の支払額116
現金及び現金同等物の増減額(▲減少)	▲ 609	▲ 556	▲ 53	
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,424	5,973	▲ 548	

◆POINT◆

- ・現金及び現金同等物の残高は5,424百万円となり、前年同四半期末比548百万円減少しました。
- ・前連結会計年度末からは609百万円減少しました。

配当の状況

(単位:円)

	17/3期 (期末と年間は予想)	16/3期
第2四半期末	3.50	3.50
期末	3.50	3.50
年間	7.00	7.00

◆POINT◆

- ・平成28年11月11日開催の取締役会において、中間配当金3.50円を決議しました。
- ・期末配当金については、予想を変更しておりません。これにより、年間配当金は7.00円を予定しております。

17/3期連結業績予想

(単位: 百万円)

	17/3期	
	上期	通期(予想) ①
売上高	15,021	33,000
営業利益	377	1,500
経常利益	312	1,450
親会社株主に帰属する当期純利益	▲ 1,717	▲ 783

16/3期	
上期	通期 ②
16,564	32,372
1,016	1,560
1,149	1,759
715	1,010

通期増減 ①－②
628
▲ 60
▲ 309
▲ 1,793

◆POINT◆

・17/3期 上期の売上高のセグメント別内訳は、下表のとおりです。

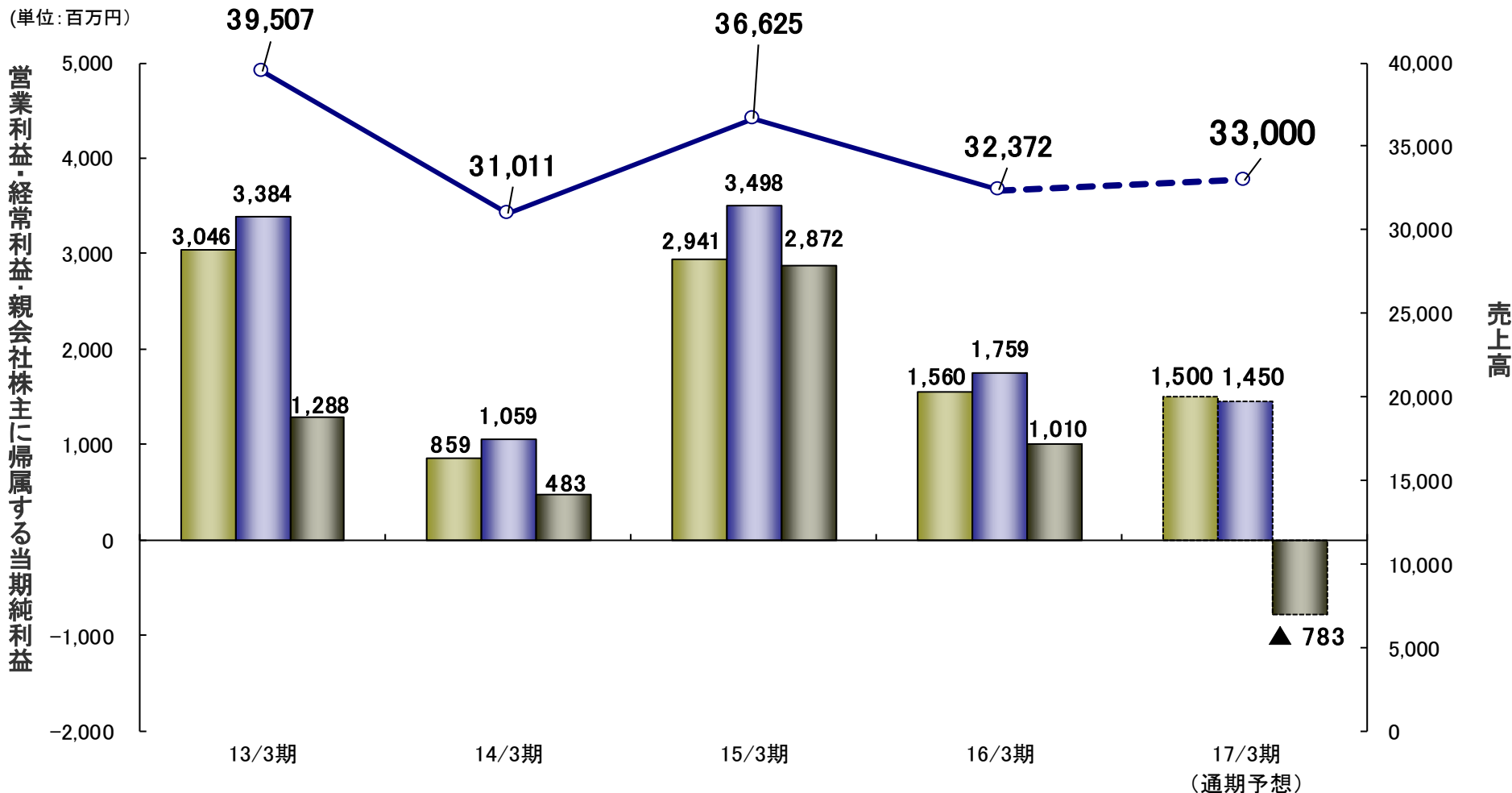
・通期の連結業績予想につきましては、平成28年10月11日に発表した数値を修正しておりません。

(単位: 百万円)

売上高	17/3期 上期	16/3期 上期	上期増減
エレクトロニクス事業部門	3,534	4,201	▲ 15.9%
メカトロニクス事業部門	1,969	1,627	21.1%
ケミトロニクス事業部門	5,263	5,487	▲ 4.1%
コンポーネント事業部門	4,252	5,248	▲ 19.0%
合計	15,021	16,564	▲ 9.3%

【ご参考】 連結経営成績の推移

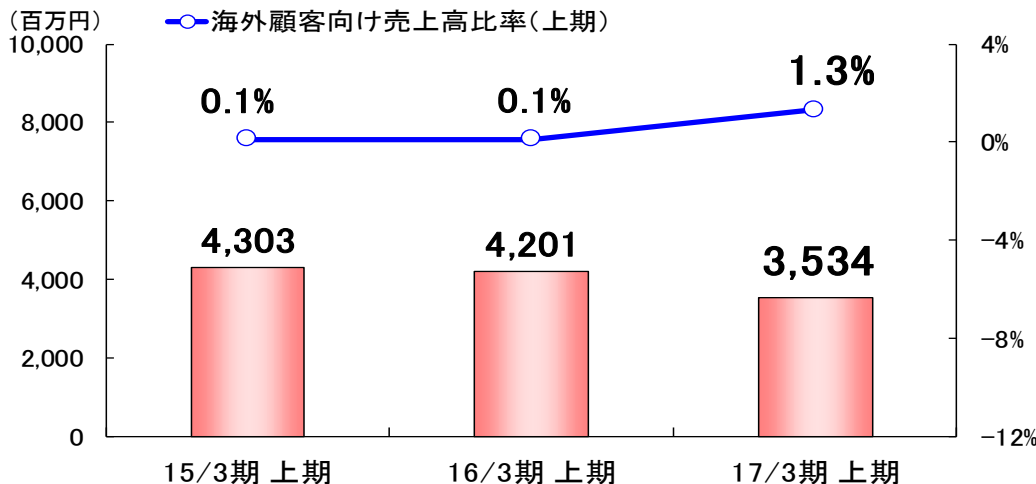
営業利益(通期) 経常利益(通期) 親会社株主に帰属する当期純利益(通期) 売上高(通期)



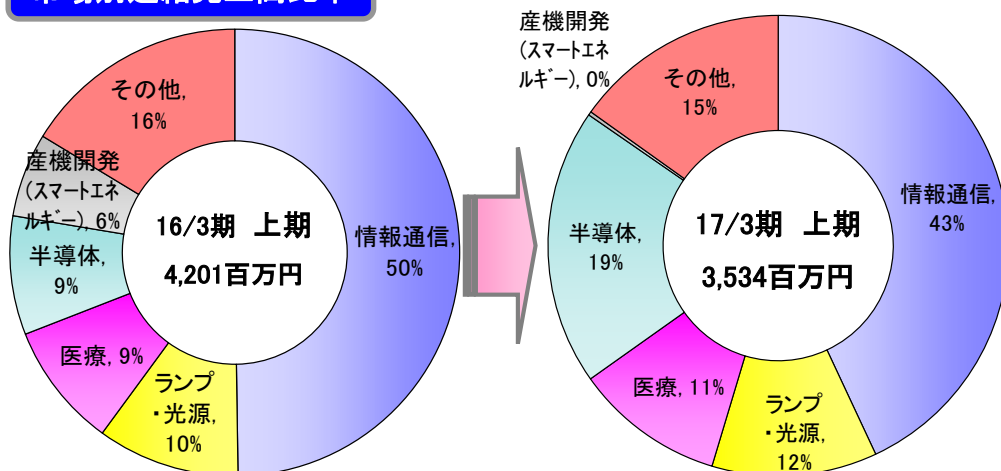
エレクトロニクス事業部門

概況

連結売上高



市場別連結売上高比率



◆POINT◆

◇17/3期 上期概要

- ・売上高は前年同四半期比15.9%減の35億3千4百万円(総売上高の23.5%)となりました。
- ・液晶製造装置向けの高電圧電源については大型の設備投資需要があり伸長致しましたが、スマートフォンなどの携帯端末向けの無線基地局用電源の投資については首都圏エリアで一巡したことから減速し、更に一部の停電対策等の用途においても伸び悩みました。

◇17/3期 下期重点施策

- 1.通信用電源は、開発中の電源の立ち上げを控えており、計画生産に向けた準備を行う。
- 2.高電圧用電源は、液晶製造装置向けの追加受注が予想されますので納期遵守に注力します。
- 3.スマートエネルギー用電源は、蓄電・スマートエネルギー市場での拡販に向け関連企業へのPRを積極的に進めてまいります。

トピックス1

高電圧直流給電電源装置

◇高電圧直流(HVDC)マルチ出力電源装置

【特長】

- ◆ 商用AC200V入力をDC380Vに変換し出力
- ◆ DC380V出力を装置内でDC48V出力に変換し出力
- ◆ 5kWユニットの積上げ方式で50kWまで対応可能
- ◆ 将来的にDC380V高電圧直流負荷に使用が可能であり、現在の通信用電源で主流のDC48Vにも対応が可能

【用途】

- 1) 通信用電源
- 2) 蓄電池充電装置
- 3) 直流系統連携



トピックス2

バックアップ用電源システム

◇バックアップ用電源システム：屋外仕様

停電時の踏切動作をバックアップする為の
屋外仕様の電源装置。

Ni-MH※電池を搭載し、鉛蓄電池を搭載
するシステムに対して小型化を実現。

※Ni-MH: Nickel Metal Hydride

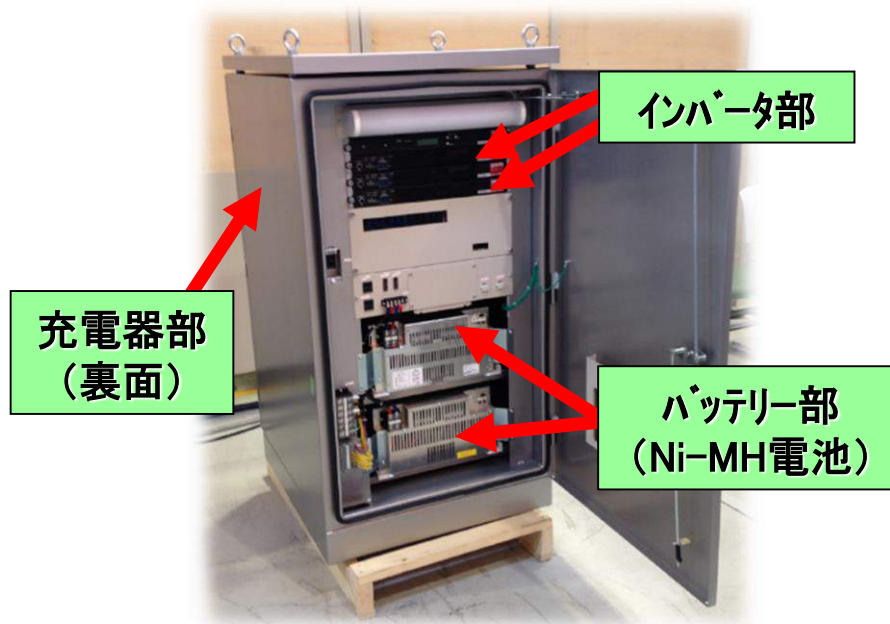
踏切試験風景



【主仕様】

入力：単相100V 常時商用

出力：単相100V 停電時バックアップ（1時間）



トピックス3

医療用X線ジェネレータ

◇医療用X線ジェネレータ

従来のインバータ、高圧部に加えスタータ等の周辺回路も取込み、付加価値を高めたシステム製品として開発。

国内のみならず、アジア中心に展開中。



General Specifications

Generator Type	High Frequency Output
Rotor Supply	Low Speed Starter
Input Phase/ Voltage	1 Φ / 180-220V AC or 3 Φ / 380-440V AC
Tube Operation	1 tube
Automical Programs	225+ techniques
Technique Selection	kV/ AEC, kV/ mAs or kV/ mA/ ms
Auxiliary Room & Collimator Power	Standard feature

Radiography

kV p Range/Steps	40 - 150 kV
kV p Accuracy	Less than $\pm 3\%$
High Voltage Ripple	Less than 10%p-p at 100kV/500mA
Rise Time(10% - 90%)	1msec (10-75%) max <0.5ms, faster rise time available for 50kW,65kW models
mA Range	10 - 630 mA
Exposure Timer Range	0.001s - 10s
mAs Range (non-AEC)	0.1- 630 mAs

Continuous Fluoroscopy

kV p Range/Steps	50 - 125 kV in 1 kV steps
kV p Accuracy	less than $\pm 3\%$ max
High Voltage Ripple	less than 10%p-p at 125kV/4mA
mA Range/Steps	0.1mA- 4mA

トピックス4

第75回中国医療機器展示会(CMEF) 出展

◇「第75回中国医療機器展示会(CMEF)」へ出展
中国(上海):2016年4月17日～20日

今回で11回目の出展となり、
医療用X線電源 各シリーズの製品紹介を実施

【主な出展製品】

- ・一般撮影用 50kWジェネレータシステム
- ・外科用Cアーム用 3.5kWモノタンク
- ・歯科用 1kWモノタンク



出展風景

◇单独运转防止装置

従来の5kvar出力に加え10kvar出力の装置を新リリース。より大きな発電設備も対応可能に！

【裝置外觀】



主要製品紹介：情報通信用電源

通信センター局用整流装置

特 長：

DC48V出力4A～6000A、小容量から大容量までの整流装置をラインナップしています。

大容量の整流装置は、システム構成により高密度実装の50A/100A/150A/200A/250Aの整流器ユニットを搭載しています。

更に予備機のある並列冗長運転方式を採用した、信頼性の高い電源装置です。

高電圧直流給電整流装置（HVDC=High Voltage Direct Current）は、高効率、安全性、デザイン性を重点にし、DC380V出力容量最大105kW供給可能な電源装置です。

使用例：データセンター、通信センター局



移動通信基地局用整流装置

特 長：

DC48V出力6A～600Aの屋外仕様タイプから屋内仕様タイプまでの整流装置をラインナップしています。屋外仕様タイプでは電柱に取付が可能な小型・軽量・無騒音（FANレス）の整流装置もあり、屋内仕様タイプでは高さ1U（44.45mm）の小型・薄型・高密度実装の整流器ユニットを搭載した電源装置もあります。

使用例：携帯電話、スマートフォンの無線基地局



主要製品紹介：情報通信用電源

インバータ

特 長：直流入力を交流正弦波出力に変換する高効率インバータです。
当社の整流器との組合せにより、各種バックアップニーズに対応することが出来ます。
また各種機能・条件などお客様のご要望のカスタマイズも可能です。

用 途：各種バックアップ電源



パッケージ電源

特 長：高信頼性で多出力に対応したパッケージ電源は
お客様のご要望を最適設計にて実現致します。

用 途：通信用、エレベータ用等



主要製品紹介：高電圧用電源

電気集塵機用電源

特 長： 煤塵を静電気により除去するための電源で、1970年より7200台の販売実績がある、業界トップの製品です。

用途： 環境に配慮した廃棄物処理設備
使用例： 電力、鉄鋼、セメント、硝子・産業廃棄物等の処理プラント



医療装置用電源

特 長： X線用高電圧電源で高周波インバータを用い、安定した出力、高信頼性、小型化を実現しています。

用途： X線発生装置
使用例： 医療用X線装置



UVランプ用電源

特 長： 高周波インバータを用い、小型化、高安定出力を実現しています。FPD生産ライン用ではシェアNo. 1です。

使用例： FPDパネル貼り合せ、印刷機



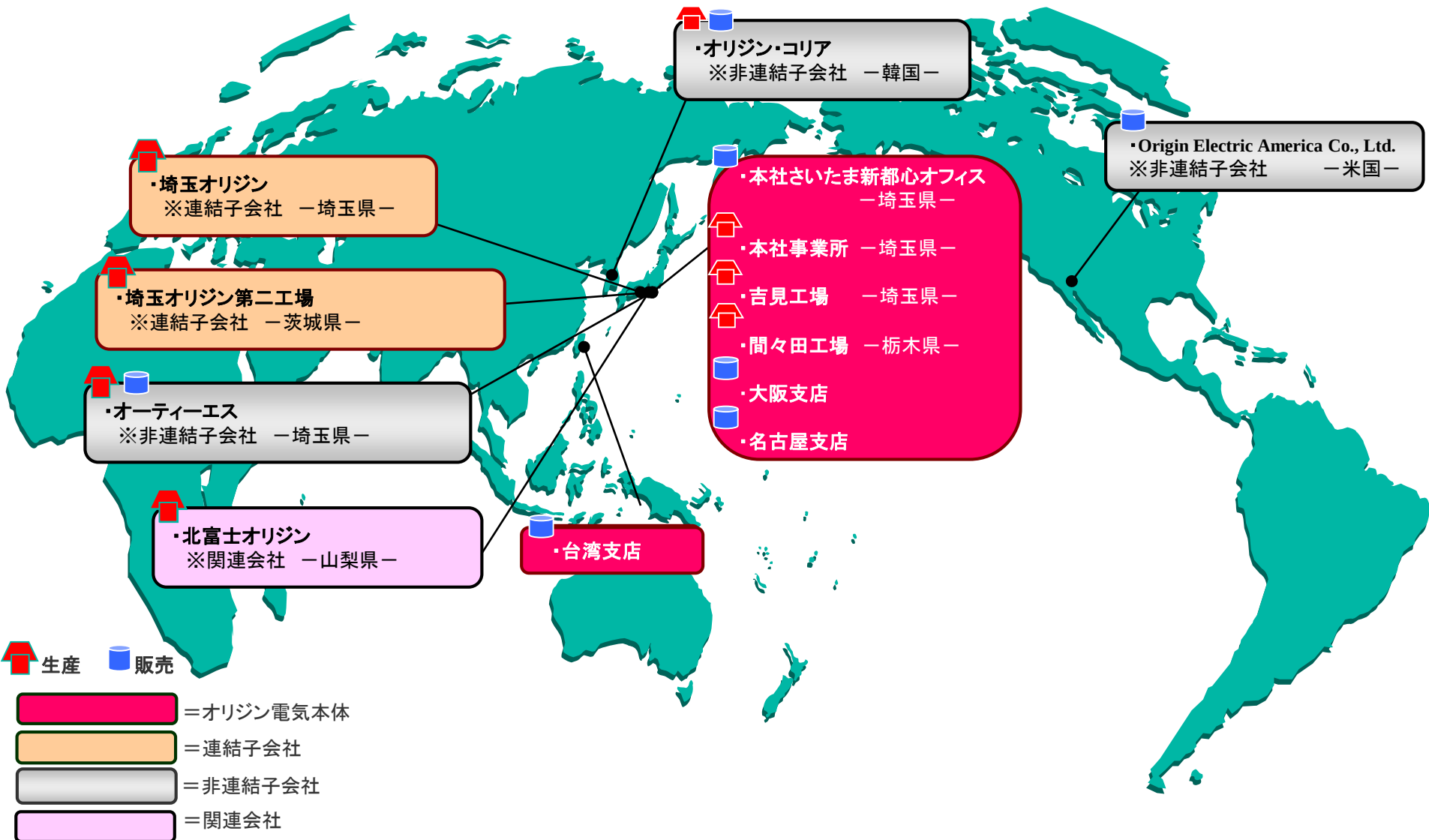
半導体・液晶製造装置用電源

特 長： 高電圧技術を活かし、半導体製造装置用など様々な製品を供給しています。

使用例： 半導体プロセスにおける材料成膜、太陽電池パネル、有機EL、液晶、PDPの成膜



生産・販売拠点

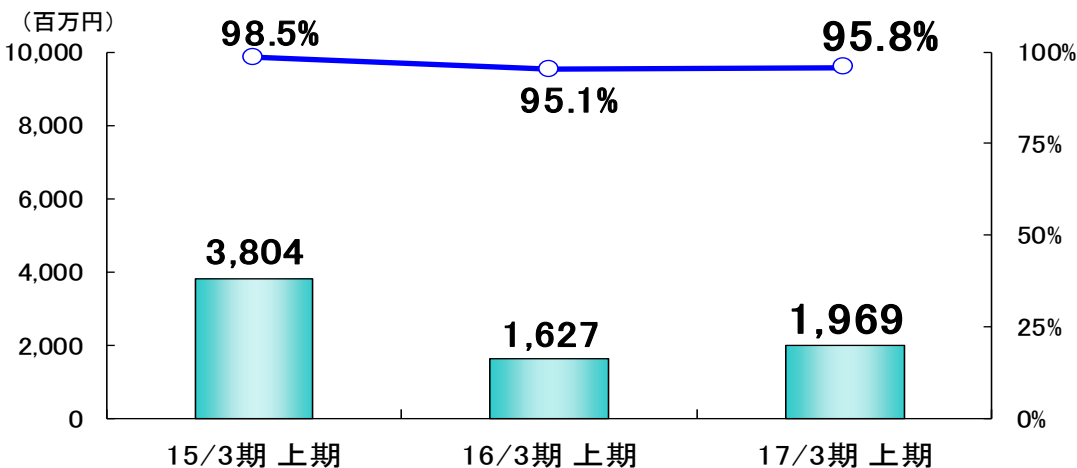


MEMO

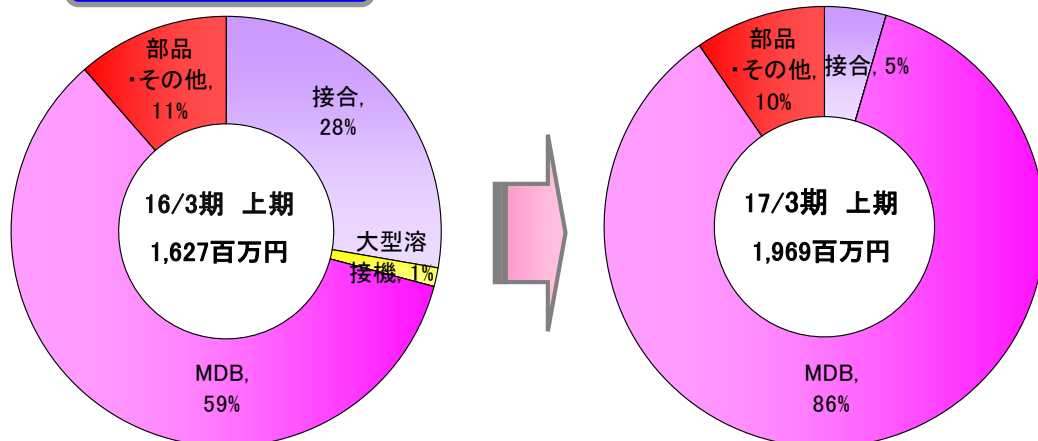
メカトロニクス事業部門

概況

売上高



市場別売上高比率



POINT

◇17/3期 上期概要

- ・売上高は前年同四半期比21.1%増の19億6千9百万円（総売上高の13.1%）となりました。
- ・光半導体用小型溶接機は新製品を発表、拡販が進みつつあるも、売上までには至りませんでした。
- ・主力のMDBは前期受注案件の既存設備の改造案件が売上げに寄与しました。

◇17/3期 下期重点施策

1. 小中型パネル用MDB量産装置の市場拡大
 - ・中国ローカルメーカーへの拡販
 - ・設備の全自動化、インライン化構築
2. 真空ソルダリングシステムの新規顧客への拡販
 - ・拡販活動の拡大、外部との協調による拡販
3. 自動車部品用大型溶接機の新規顧客への拡販
4. 光半導体用小型溶接機の新製品による売上確保
5. 大型新製品(第5の柱以降)の開発推進

製品群(4本の柱)

重点製品とターゲット市場

1. 【MDB】(Mobile Display Bonder)

モバイルディスプレイ用貼合せ装置

→中国ローカル市場



3. 【CSW】(Cap Seal Welder)

光半導体用小型溶接機

新製品市場投入！

→アジア光通信市場



2. 【RMW】(Ring Mash Welder)

自動車部品用大型溶接機

→国内・海外
自動車関連市場



4. 【VSM】(Vacuum Soldering Machine)

真空ソルダリングシステム

→国内・アジア
パワー半導体市場
LED市場



重点製品1-1

MDB



MDBロードマップ

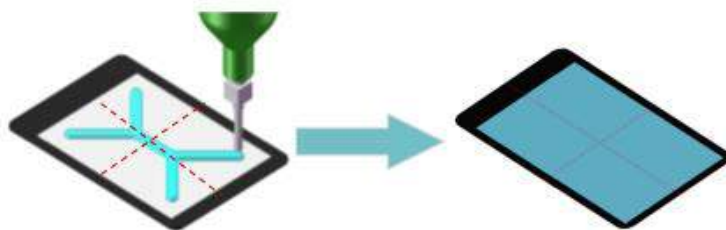


小中パネル用MDB

小中型パネル用MDB

2工法により幅広いディスプレイ貼合せニーズへ対応

◇DF (Dispense Flip) 工法 オープンセル基板に最適



- 常圧環境でも気泡レス
- 小型化が容易
- 低コスト

展延コントロールにより塗布液は決まれた位置まで広がり、はみ出すことはありません。

◇C2L (Slit coat) 工法

大型基板や剛性が低い基板
(LCDモジュール等)にも最適

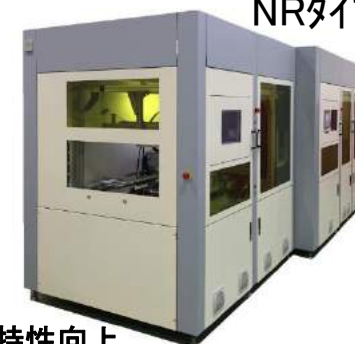


- スリットコート方式による面塗布採用
- 面塗布及び仮硬化によるはみ出し・膜厚特性向上
- 狭額縁タイプ(高品位製品)の貼合せに効果発揮

LCタイプ

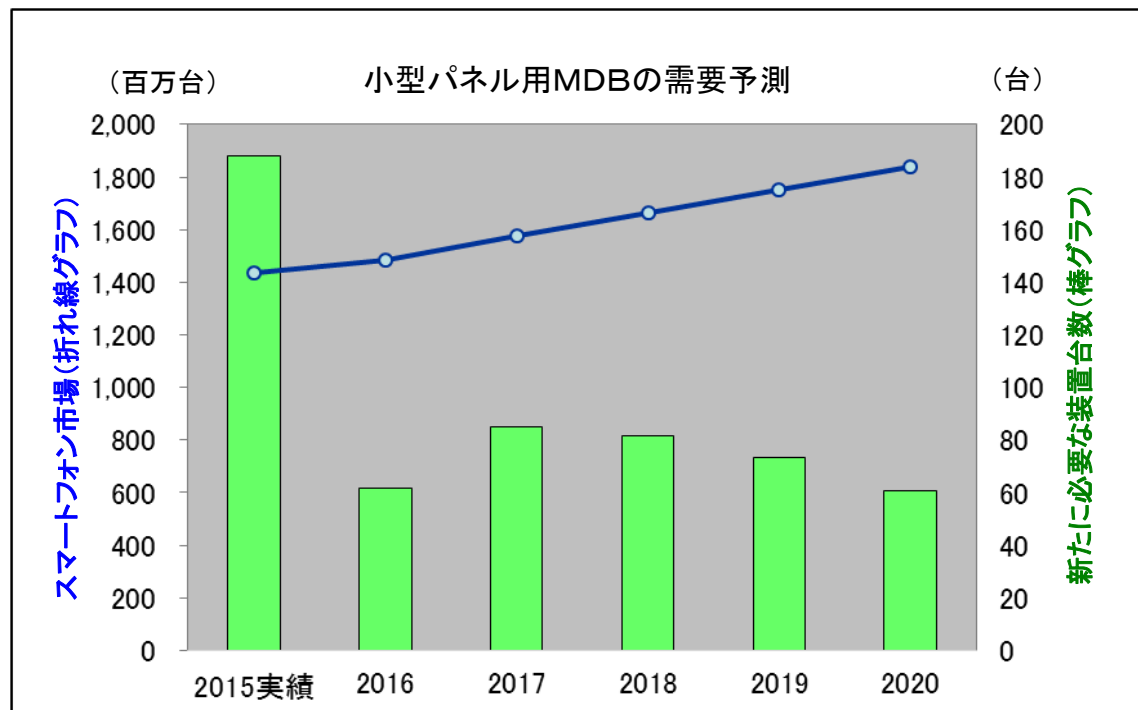


NRタイプ



MDB市場

MDB市場



2016/6版

スマートフォンの世界市場予想データ(IDC予測)を基に、
小型パネル(2~5")用MDBの需要を予測(2017年以降はインライン装置換算での予測)

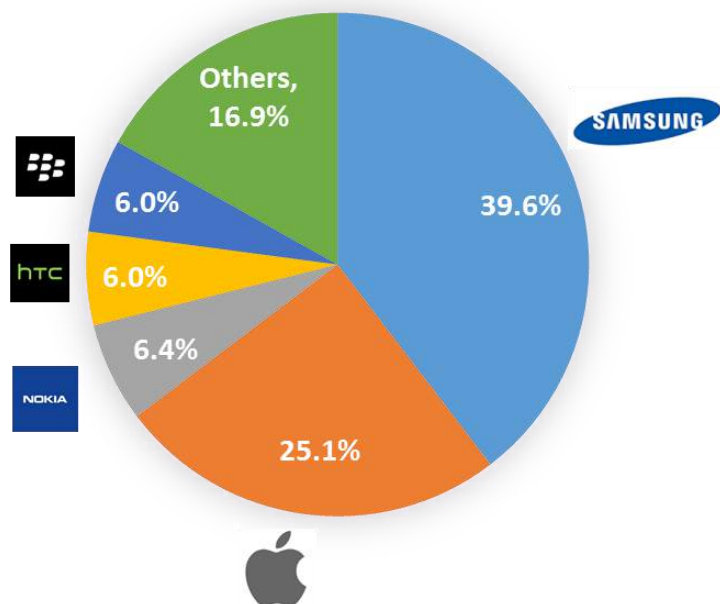
LCタイプ



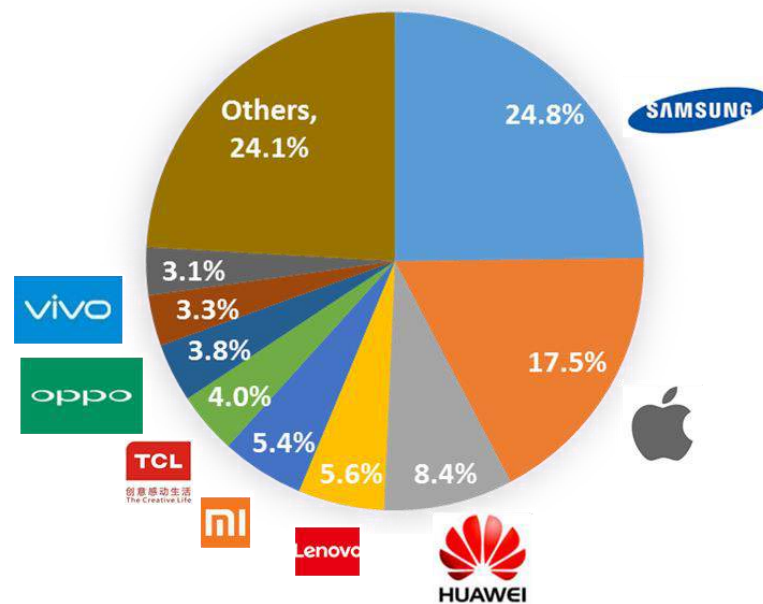
スマートフォンの世界市場シェア

MDB市場

2012年度 545.2百万台



2015年度 1,292.7百万台



* 中国ローカルメーカーの台頭

データ出処: 2016/1/14 TrendForce

今後も中国勢は国内の他、東南アジアやインド、アフリカなど新興国市場への輸出を拡大させるものと思われます。

RMW コンデンサ式大型溶接機+リングマッシュ接合

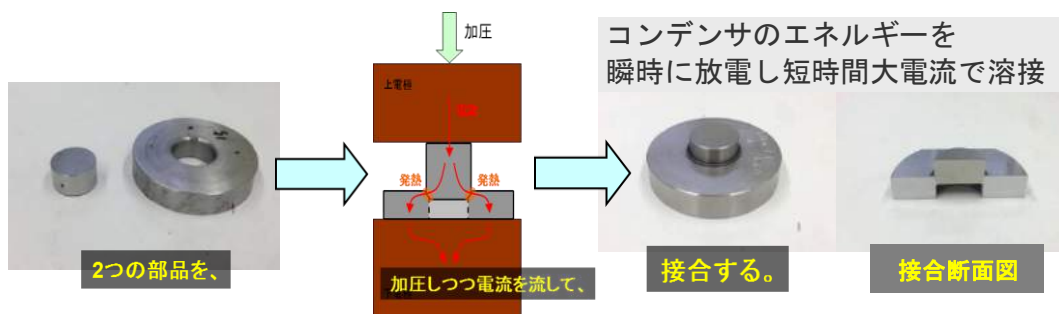
電子ビーム代替として複数の自動車関連メーカーで採用拡大

◇用途：自動車やオートバイなどの同軸駆動系部品の溶接

コンデンサ式大型溶接機

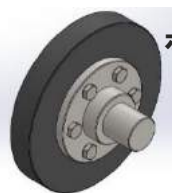


リングマッシュ接合



リングマッシュ接合のメリット

- 部品の削減 & 軽量化
- 工数の削減 & 生産タクトUP
- 安価な加工コスト & 高トルク・高精度



ボルト締結



リングマッシュ接合

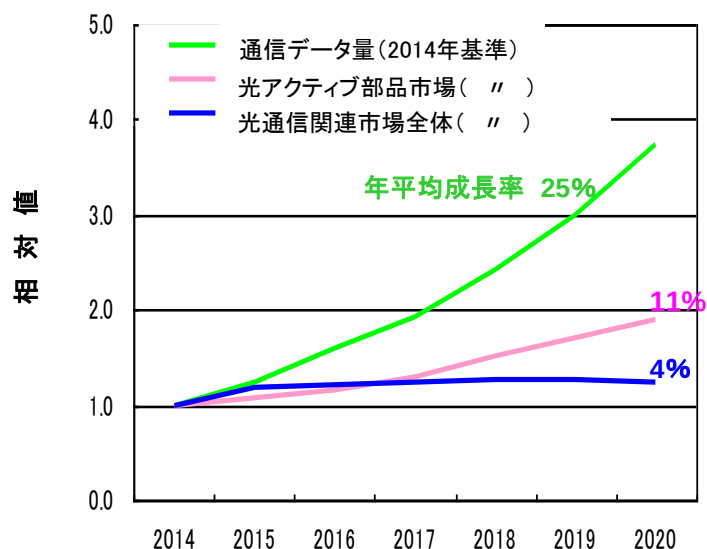
接合部品例

- デファレンシャルギヤ
- トランスミッションギヤ
- トルクコンバータ
- その他

光半導体用小型溶接機(光通信関連)

光通信関連市場向け

通信データ量と光通信市場の将来予測



・通信データ量: 米シスコシステムズによる予測
 ・光通信関連市場全体・光アクティブ部品市場:
 「2015光通信関連市場総調査」富士キメラ総研

2016年下期に新型“CS3”
を市場投入(新製品)

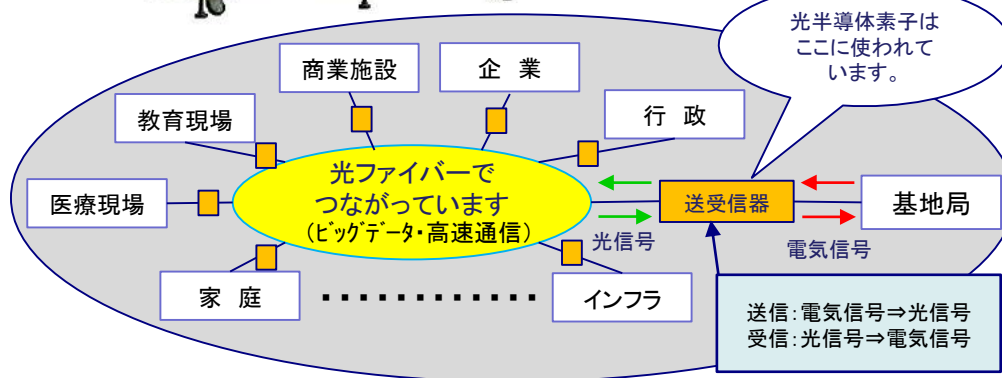


この部分を溶接してキャップと
発光素子を接合します

キャップ

発光素子

光半導体素子は
ここに使われて
います。



VSM 真空ソルダーリングシステム (ボイドレス)

パワーデバイス用次世代半田付け装置

ぎ酸還元と圧縮法によりボイドレスを実現（はんだ飛散も同時抑制）

還元力の高いぎ酸をクローズド処理で安全に運用

真空プロセスでのスムーズな温度コントロール

用途：自動車（HV・EV）、鉄道車両駆動、家電インバータ、産業用MW用モータ

真空中での温度最適化

温度コントロール

業界で初めて装置化を実現

圧縮法
（真空利用）

クローズド処理による安全運用

ぎ酸利用
（はんだ濡れ性UP）

はんだ飛散抑制

回路絶縁不良を解決

ボイドレス

応力集中ホットスポットを解決

IGBTの歩留り向上

※IGBT：パワー半導体モジュール



VSM 真空ソルダリングシステム (ラインナップ)

装置ラインナップ

顧客ニーズへの更なる追求 = 装置仕様の最適化

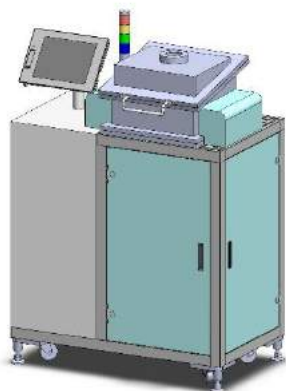
・ V E 提案 ・ V A 提案 ・ コストダウン ・ 既存装置の刷新

バッチタイプ

VS 1

VS1は研究用途から少量生産に適したコンパクトバッチモジュールです。
ワークの出し入れは人手で行います。

装置寸法 W850×D850×H1300



インラインタイプ 新型MP2

MP2 は加熱と冷却を独立させた 2 チャンバ仕様の量産設備です。
処理スペースはW380 x D310 x H100mm と大型ワーク搭載まで可能です。

装置寸法 W1,880×D1,800×H1.880
供給排出ユニットを除く本体部のみ

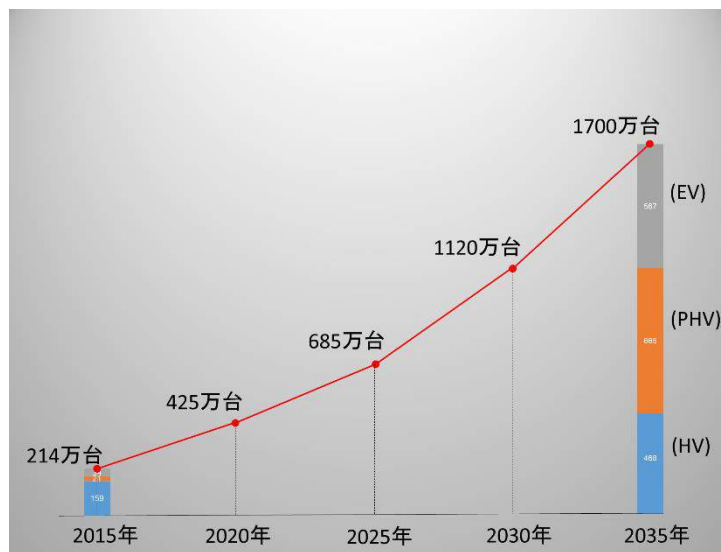


VSM 真空ソルダリングシステム(市場)

真空ソルダリングシステム市場

パワー半導体市場

HV / EV車の販売台数予測

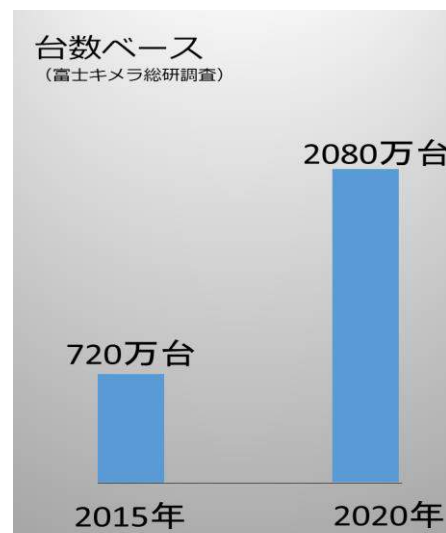


※2016/6/15 富士経済調査データ

HV/EVの市場拡大とともに、それに数多く搭載されるIGBTは今後大幅な需要増が期待されます。

LED市場

LEDヘッドランプシステム需要規模



※2016/3/28 富士キメラ総研調査データ

<新市場の開拓>

車載向けパワーデバイス以外のターゲットとしてLED分野が上げられます。特に車載向けLEDヘッドランプシステムは、搭載される世界の自動車台数が2015年の720万台から2020年には2080万台まで大幅に増加すると予測されています。これに伴い、必要な接合設備も大きく需要が増え、今後のLED分野への期待も広がります。

生産・販売拠点

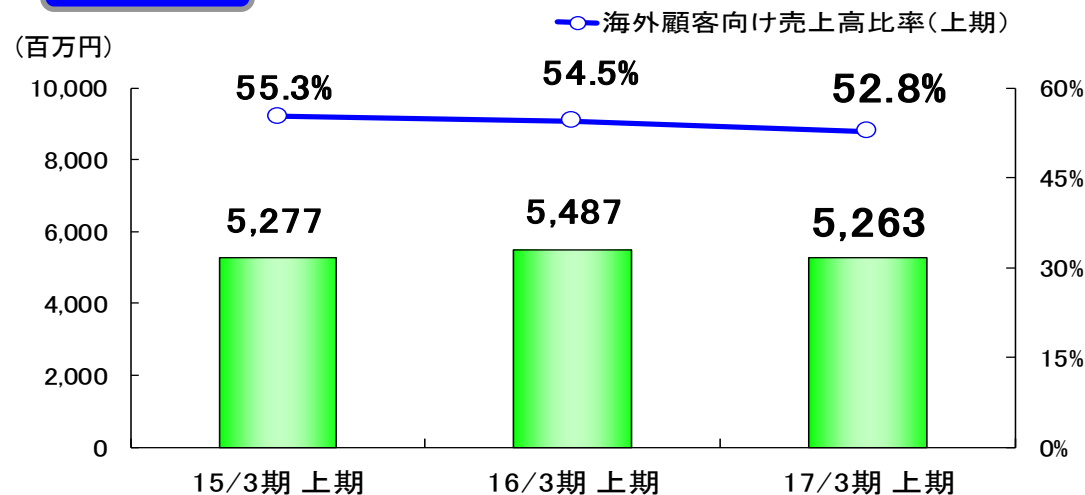


MEMO

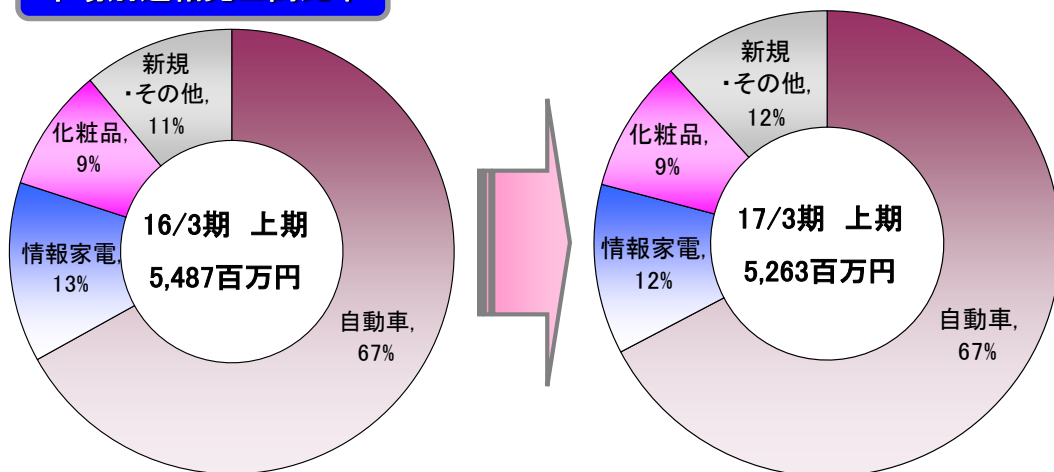
ケミトロニクス事業部門

概況

連結売上高



市場別連結売上高比率



◆POINT◆

◇17/3期 上期概要

- ・売上高は前年同四半期比4.1%減の52億6千3百万円(総売上高の35.1%)となりました。
- ・九州熊本震災の影響の中、主力の自動車関連分野は新製品を中心に比較的堅調に推移しましたが、円高の影響もあり、全体としては前年同四半期比で微減となりました。

◇17/3期 下期重点施策

1.ケミカル全般への事業領域の拡大

- ・新分野参入に向けた市場調査、新製品の開発。

2.自動車分野のグローバル対応力の向上

- ・中国、ASEANの各拠点強化及び米国、メキシコのパートナーシップ強化。インドのフィージビリティスタディ実施。
- ・各拠点との連携と品質、技術の標準化。

3.国内市場の深耕

- ・販売網の強化(九州、中国、東北)

新製品紹介

自動車内装めっき用塗料 エコネットZ

※写真は製品のイメージです

○特長

自動車内装めっき用TXF塗料であり
従来品(オリジプレートZ)の長所・特性を継承しています。

○対応素材

クロムめっき素材

○用途

自動車内装向け



PIXTA

主要製品紹介

環境対応塗料

特 長：環境への対応、自動車VOC削減への対応をしています。

使用例：・自動車内装部品
・携帯電話
・パソコン等

品 目：・水系塗料 “プラミーズ” シリーズ
・トルエンキシレンフリー塗料 “エコネット” シリーズ



プラスチック用塗料

特 長：作業性、意匠性に優れ、高付加価値を生む塗料です。

使用例：・自動車の内外装部品
・携帯電話
・パソコン
・デジタルカメラ
・化粧品容器
・スポーツ用品 等



めっき非鉄金属／蒸着部品用塗料

特 長：めっき素材、蒸着など金属調意匠の外観加工に優れた適応性を有します。

使用例：・自動車外装部品
・携帯電話
・デジタルカメラ
・パチンコ、パチスロ部品等



採用事例1

自動車採用事例
T社 ハイブリッド車

※写真は製品のイメージです

採用部品: エアコンブレード
採用塗料: エコネットEZ

採用部品: レジスターベゼル
採用塗料: エコネットET SS

採用部品: スイッチベース
採用塗料: エコネットVZ+
エコネットEB

PIXTA

採用事例2

自動車採用事例
S社 軽自動車

※写真は製品のイメージです



採用部品:ラジエーターグリル
採用塗料:オリジプレートZ

PIXTA

採用事例3

家電製品・機能性塗料採用事例

※写真は製品のイメージです



PIXTA

M 社 掃除機
採用塗料:エコネットEY



PIXTA

H 社 ナビパネル
採用塗料:UVコートTP



PIXTA

Y 社 無線機
採用塗料:プラネットSV-12

採用事例4

東邦化研工業（株）製品採用事例

※写真は製品のイメージです



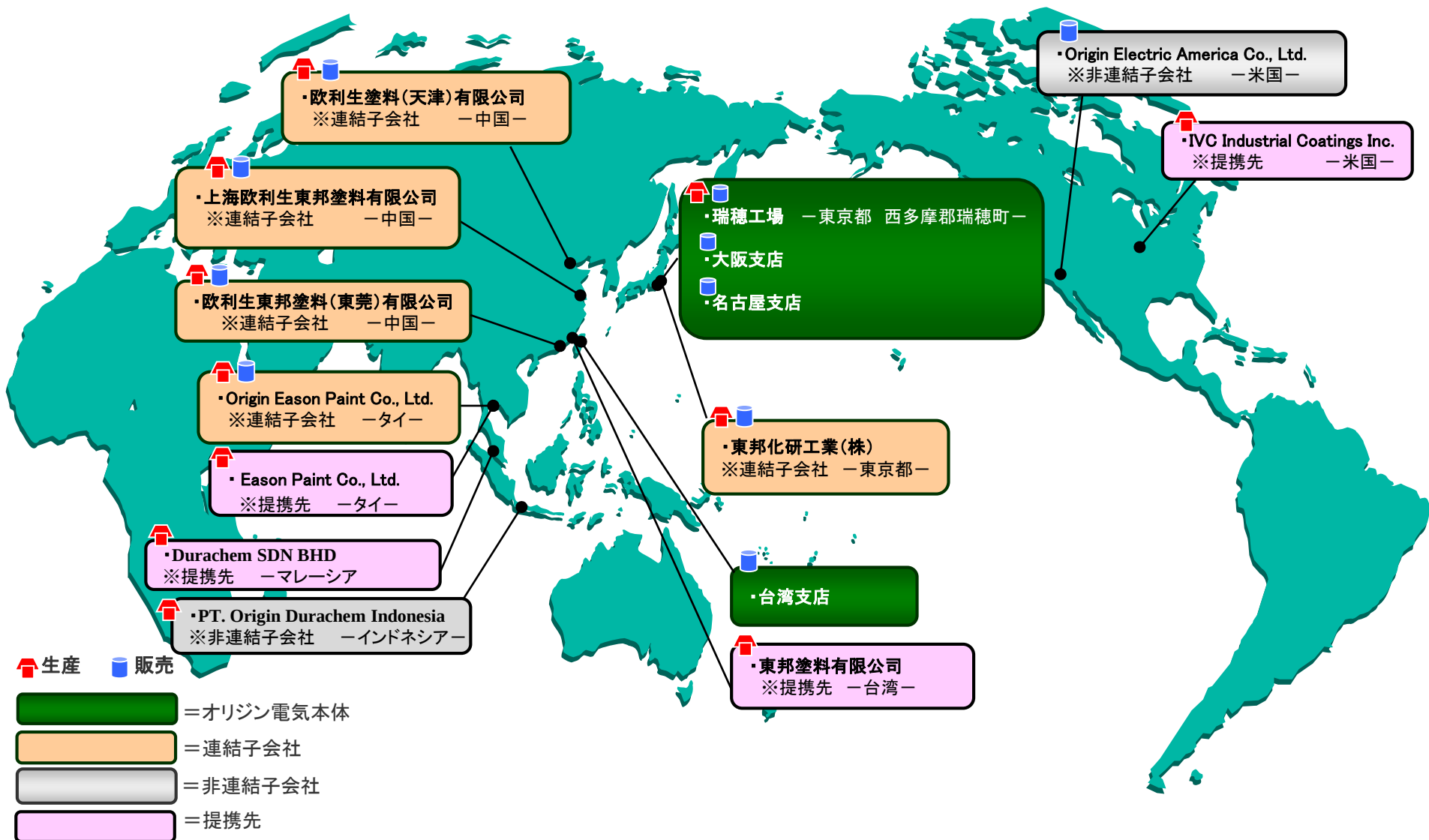
S 社 パチンコ台
採用塗料:VMCRシリーズ



PIXTA

N 社 フォグランブ
採用塗料:UVアンダー - UVトップ

生産・販売拠点



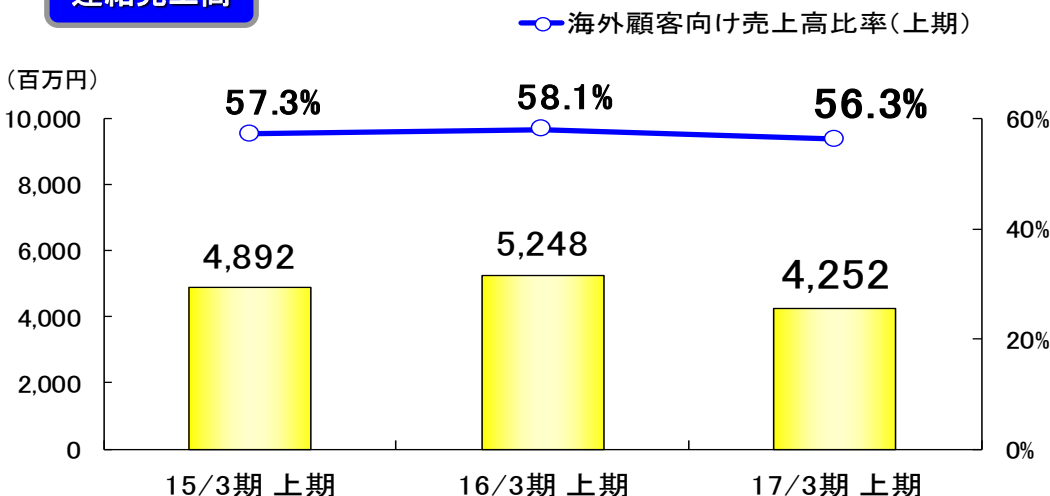
MEMO

コンポーネント事業部門

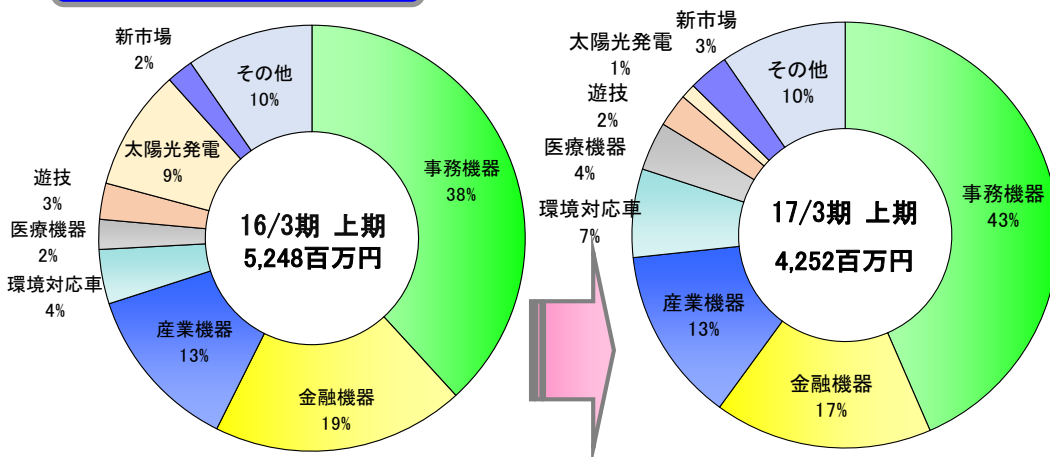
※17/3期より、半導体デバイス及び精密機構部品を統合いたしました。

概況

連結売上高



市場別連結売上高比率



◆POINT◆

◇17/3期 上期概要

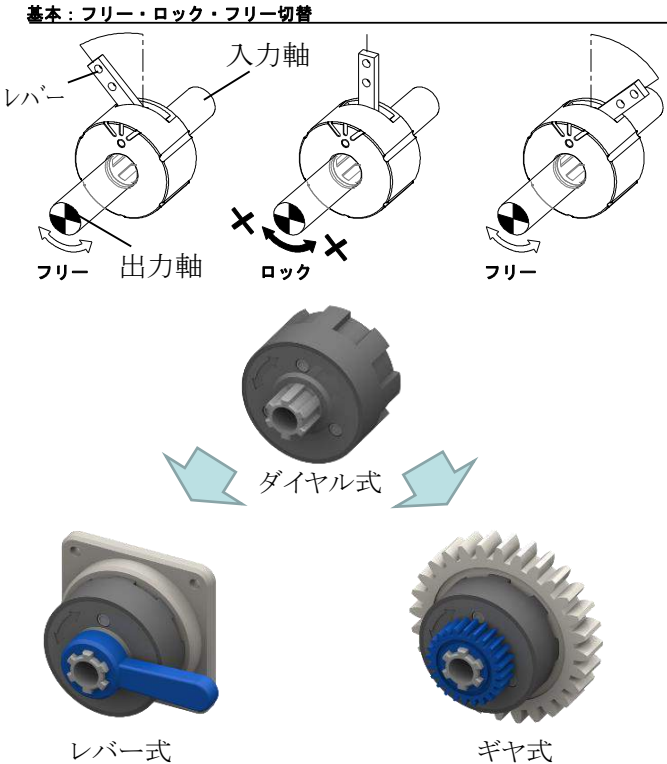
- ・売上高は前年同四半期比19.0%減の42億5千2百万円(総売上高の28.3%)となりました
- ・事務機器関連は、数量では前年同四半期比以上に推移しましたが、円高の影響に微減。
- ・金融機器関連は、依然中国市場低迷を受け大幅減。
- ・太陽光発電関連は、主要顧客動向が不透明で前年同四半期より更に厳しい状況。
- ・車載部品関連は国内市場の伸張、医療機器関連は海外新規顧客開拓により前年同四半期比微増。

◇17/3期 下期重点施策

- 1.事務機器関連の新製品拡販
- 2.金融機器関連の中国国内メーカーへの深耕
- 3.医療機器関連の海外市場への深耕
- 4.産業機器関連のカスタム製品提案
- 5.各市場への複合製品(ユニット、モジュール)の提案

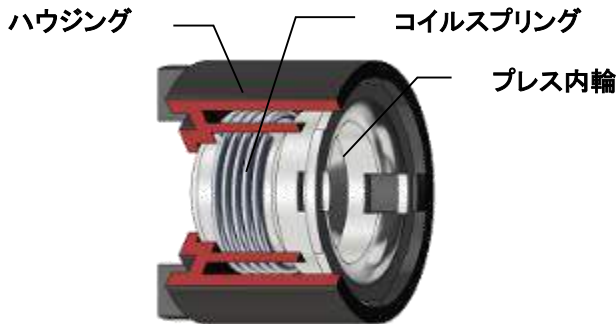
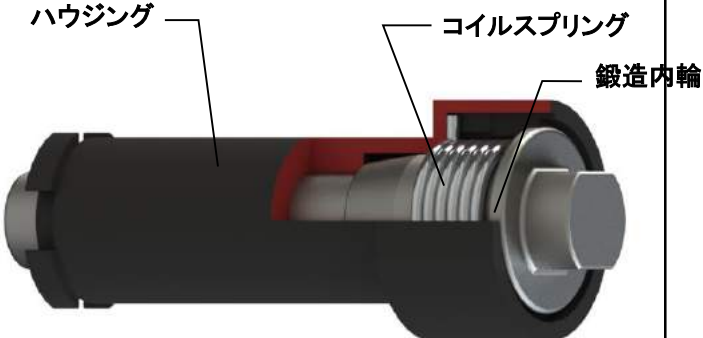
新製品紹介 ヘルスケア市場、住宅設備市場

セレクトابلクラッチ(ON・OFFクラッチ)

機能	基本：フリー・ロック・フリー切替  レバー式 ダイヤル式 ギヤ式	モデル	
		対象市場	ヘルスケア市場 / 住宅設備市場
		用途	ロック、フリーの切り替え機構
		適用例	 キャストストッパー シャッター巻取り 駆動部

トピックス1 事務機市場

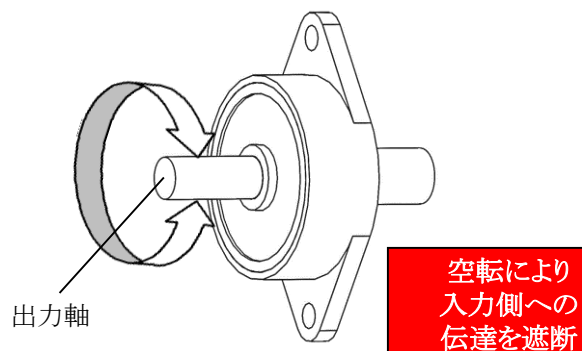
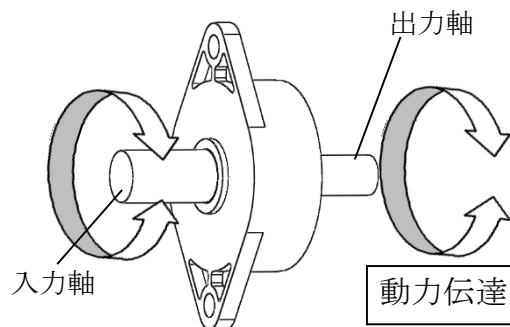
中国現地生産化(部品の現地調達化・アッセンブリ)

型式名	OTL-P型	RT型
外観・構成	 ハウジング コイルスプリング プレス内輪	 ハウジング コイルスプリング 鍛造内輪
部品調達	全部品 中国現地調達	全部品 中国現地調達
サイズ	外径 $\Phi 14.0\text{mm}$	外径最小 $\phi 12.3\text{mm}$ ゴム圧入部外径 最小 $\phi 8.5\text{mm}$
負荷トルク設定	最大 $50.0\text{ mN}\cdot\text{m}$	最大 $39.2\text{ mN}\cdot\text{m}$
耐久性	300万回転以上	100万回転以上

トピックス2 住宅設備市場

双方向フリー(OSFF型)

機能



モデル



対象市場

住宅、介護、家電

用途

電動、手動の切り替え機構

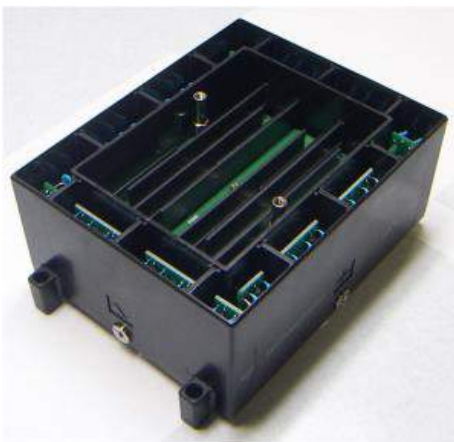
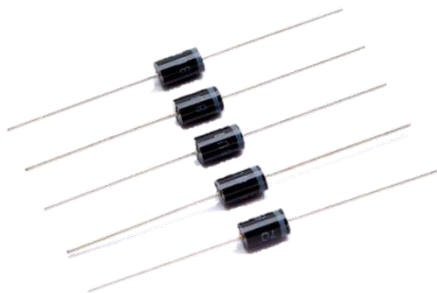
適用例



トピックス3 医療機器市場

高耐圧整流ダイオード

形状



せん頭逆電圧
(VRM)

4kV～8kV、75kV

平均整流電流
(I_o)

200mA～1100mA

特長

高耐圧=4kV～150kVまでラインナップ

用途

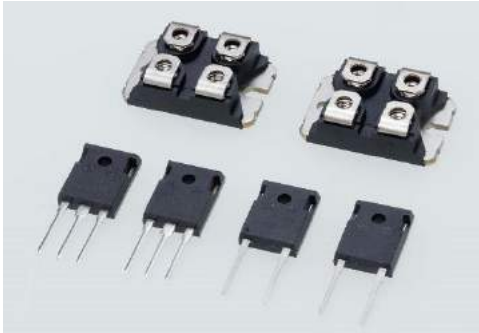


株式会社日立メディコ社製

医療用、産業機器用：X線、CT装置

トピックス4 産業機器市場

高電圧大電流高周波整流用パワーモジュール

形状		せん頭逆電圧 (VRM)	600V～1700V
		平均整流電流 (Io)	30A～400A
		特長	高耐圧、高速スイッチング、取り付け容易
		用途	  ・各種電源装置 ・大容量インバーター

主要製品紹介1

モジュール製品

特 長：超高圧対応の製品から
サージ吸収スナバーモジュール、
回路技術と組み合わせたカスタムモジュール
など多様な複合製品を提供します。

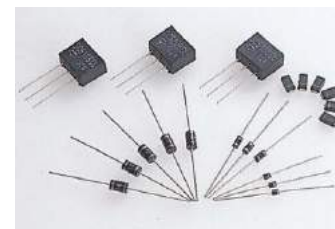
用途：大電力装置用、高電圧発生用
使用例：自動車、家庭用ソーラ、
医療用レントゲン、
電子顕微鏡



アキシャルリード部品

特 長：高電圧・高効率のサージ対策製品を
シリーズ化しています。

用途：電気製品の雷、静電気対策
使用例：エアコン、パチンコ



表面実装部品

特 長：高電圧・大電流製品を超小型で実現しています。

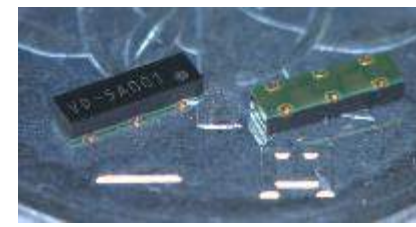
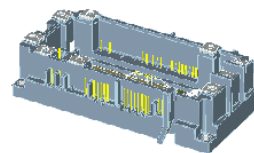
用途：電気製品の雷、静電気対策
使用例：デジタルカメラ、ゲーム機器



カスタム製品

特 長：お客様のニーズに合わせた製品を実現します。

用途：ソーラー、超小型高圧電源
使用例：パワーコンディショナー、その他



主要製品紹介2

ワンウェイクラッチ (OWC)

特 長：
一方向は空転し、
その反対方向はかみ合う機能を持った製品です。
主にワンウェイクラッチと歯車・ローラなど
を一体化した製品として用いられます。

使用例：・金融機器（ＡＴＭ等）
・ＯＡ関連機器
・自動発券機
・半導体実装装置



トルクリミッタ (OTL)

特 長：
設定トルクを境に回転トルクを伝達したり、
スリップをして遮断する機能製品です。

使用例：・金融機器（ＡＴＭ等）
・ＯＡ関連機器
・自動発券機
・各種安全機構



ワンウェイヒンジ (OWH)

特 長：
ワンウェイクラッチとトルクリミッタの機能を
兼ねそろえたヒンジです。
従来のヒンジでは開ける時と閉める時で発生トルク
は同等ですが、この製品は一方向にフタ等を保持
するための負荷トルクを有し、他方向ではトルクを
発生せず空転状態となります。

使用例：・ＯＡ関連機器
・各種機器のフタ
・ユニットの開閉機構



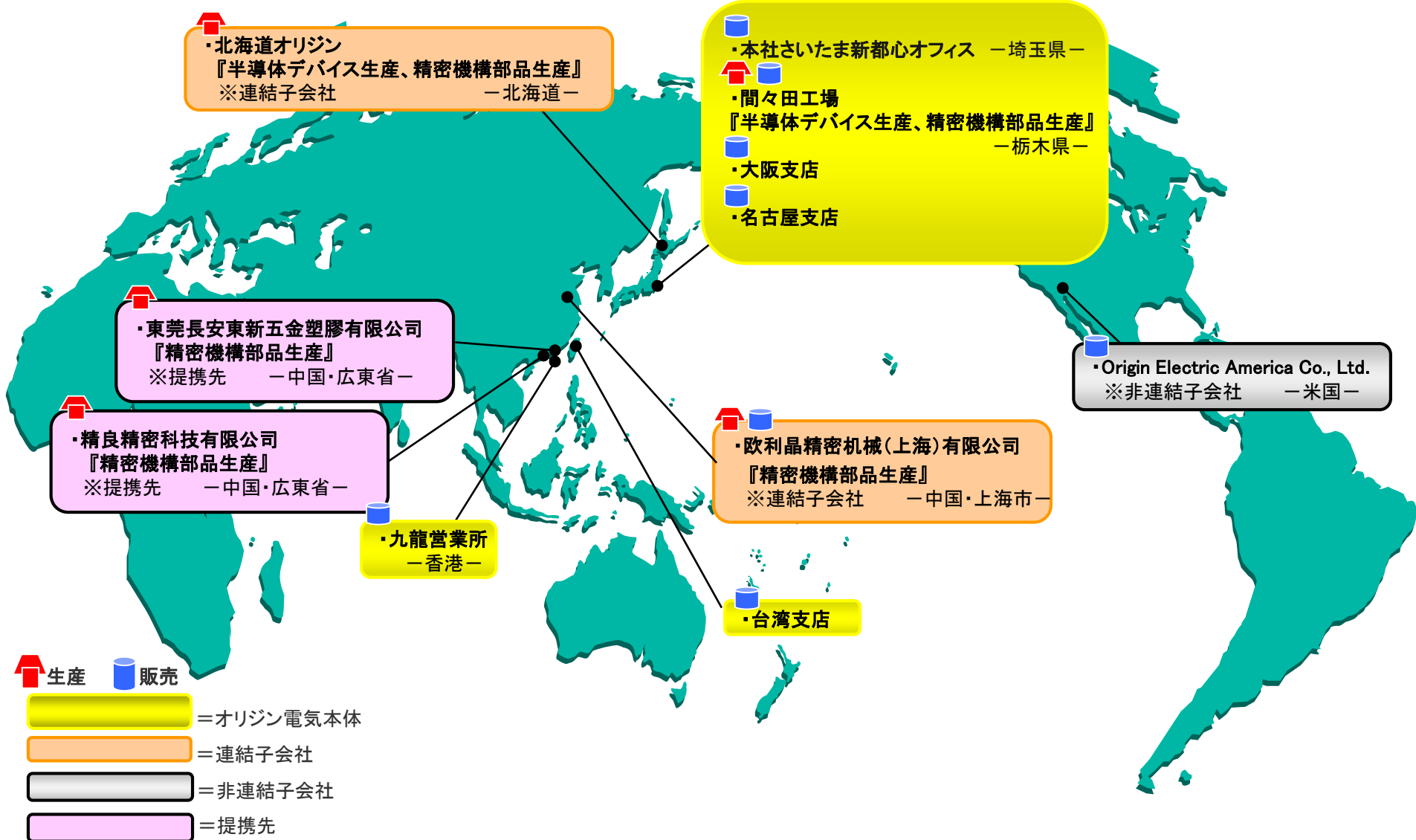
ベアリング

特 長：
ミニチュアボール軸受とプーリ・ギアや軸等の
精密加工部品を複合的に組立てたユニット製品です。
数々のベアリング製造より得られたノウハウを活かし、
高精度かつ高品質な対応をしています。

使用例：・金融機器（ＡＴＭ等）
・工作機械
・自動発券機
・半導体実装装置
・医療機器



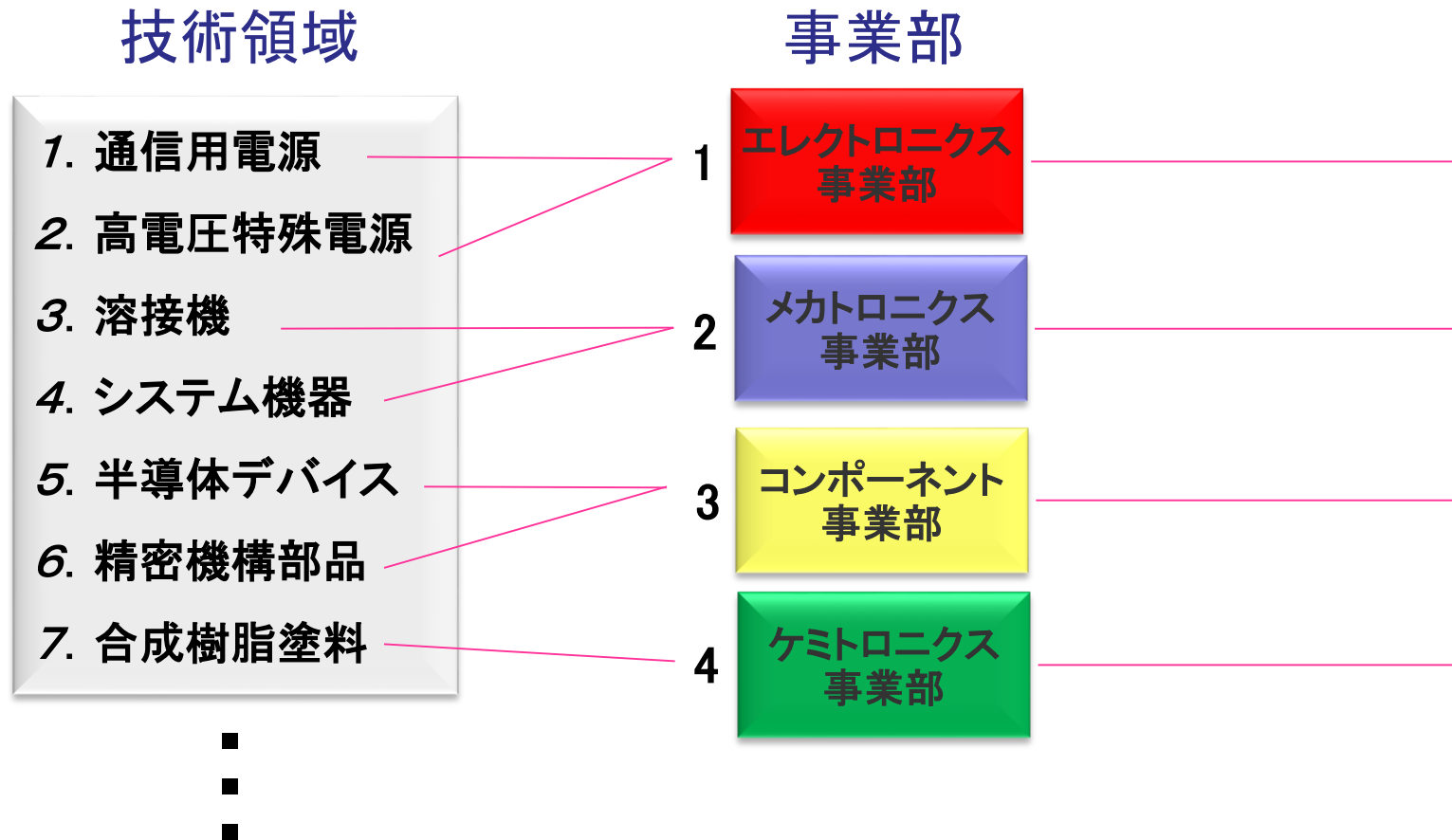
生産・販売拠点



技術・製品開発力の増強と強化 研究開発本部

1. オリジン電気の技術領域
2. 技術開発体制の整備
3. 基幹技術、科学力の増強、全階層による
トータルな製品開発力の強化

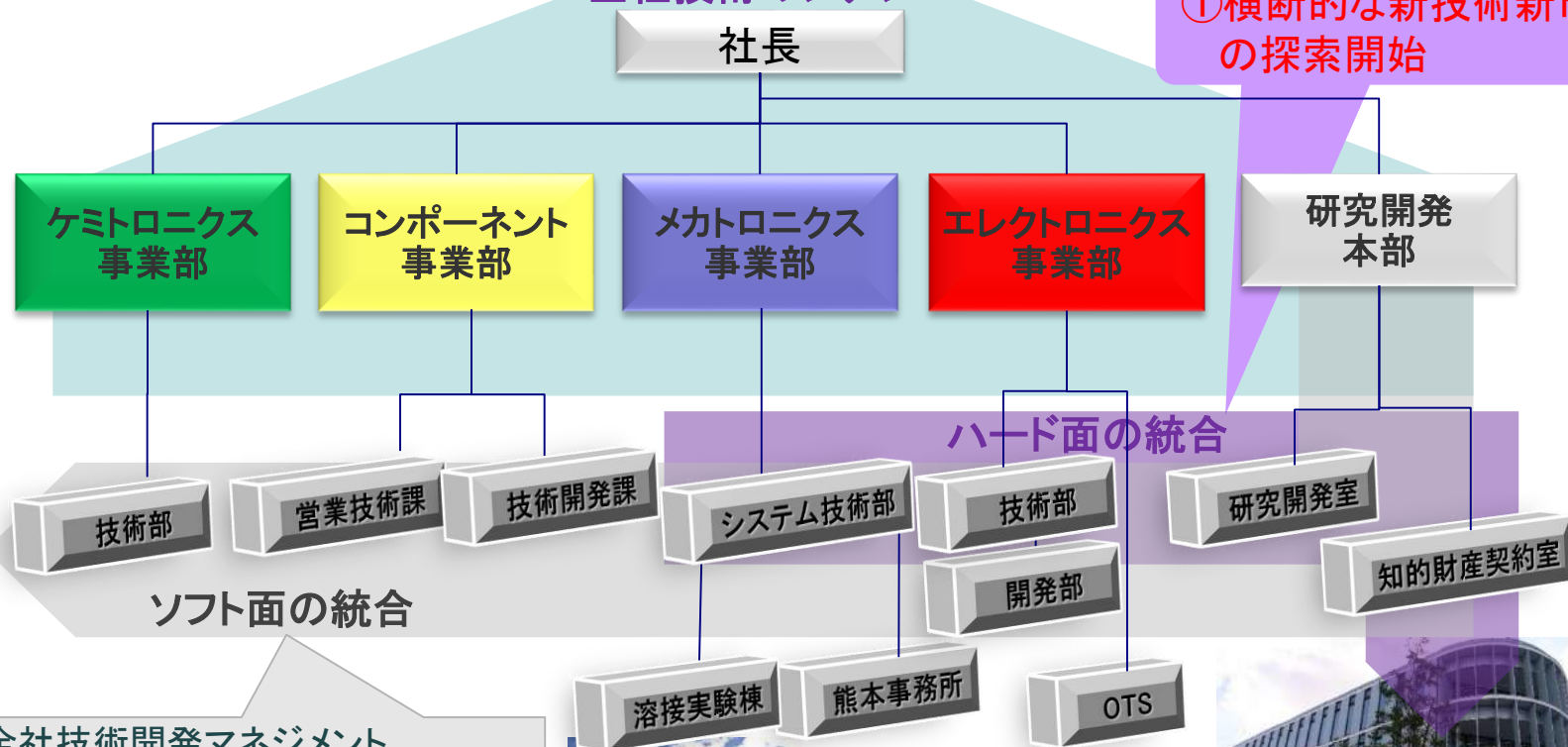
オリジン電気の技術領域



技術開発体制の整備

新製品新事業創出
全社技術のシナジー

①横断的な新技術新市場
の探索開始



ソフト面の統合

ハード面の統合

全社技術開発マネジメント

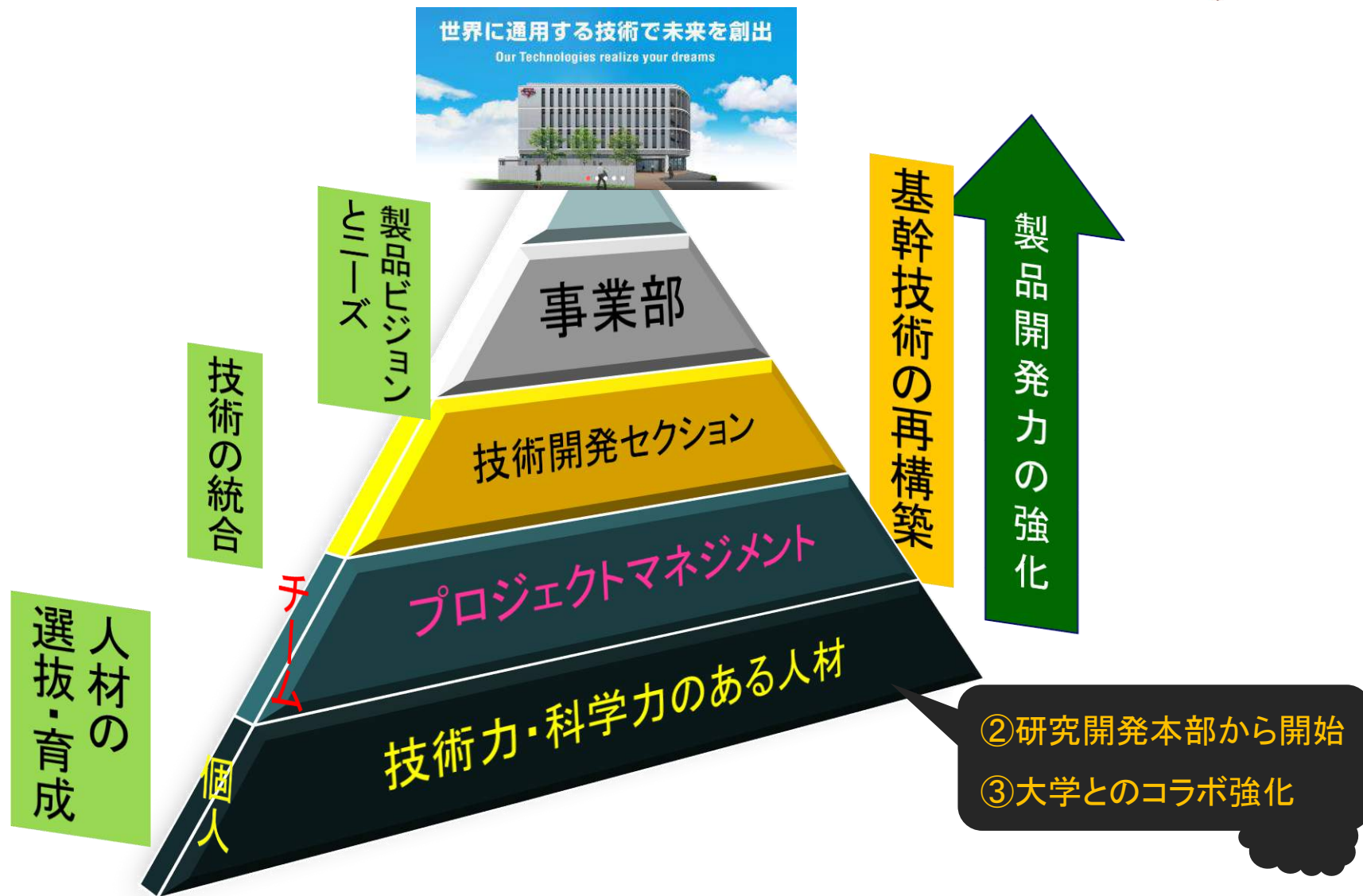
- ・中期計画の1年ローリング
- ・共通新指標(テーマバランス、新製品比率等)
- ・重要テーマへの全社リソースの戦略的集中



間々田工場8号棟



本社事業所



◇当資料はオリジン電気株式会社が作成したものであり内容に関する一切の権利は当社に帰属しています。
複写及び無断転載はご遠慮下さい。

◇当資料に掲載しております情報は、2017年3月期第2四半期決算の経営成績や財務内容等の提供を目的として
ありますが、内容についていかなる保証を行うものではありません。

◇業績予想等は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しています
ので、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。

◇当資料は当社が現在発行している、また将来発行する株式や債券等の保有を推奨することを目的に作成したも
のではありません。

————— プレス・アナリスト・機関投資家様 個別取材窓口 —————

オリジン電気株式会社

経営企画部

TEL:048-755-9422